

研华嵌入式物联网 明星产品指南(2026~2027)

Advantech Embedded IoT Group



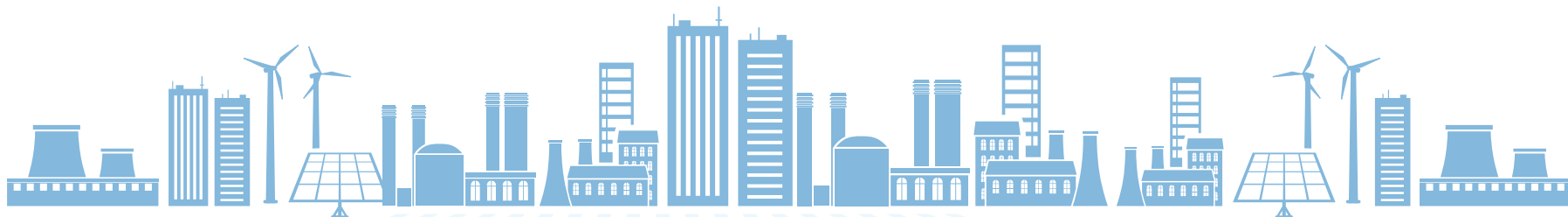
ADVANTECH

研華科技

Embedded IoT

研华嵌入式物联网平台事业群

研华嵌入式物联网事业群致力于提供完整的边缘计算与 AI 平台整体解决方案，涵盖跨 x86 与 Arm 计算架构的标准化模块、单板、系统、周边模块、软件服务及经销体系，同时提供自主系统机器人、工业级 AI 无人机应用专属方案，以及定制化设计与制造服务 (Design and Manufacture Services, DMS)。整体运营横跨产品研发、系统设计、制造以及全球本地化销售与技术服务体系，并锁定垂直产业发展，聚焦医疗、博彩、交通、工业级无人机、自主移动设备 (AMR)、机器人、设备自动化、自助服务终端等主要市场，为客户提供一站式整合服务。面对无处不在的边缘 AI 升级趋势，嵌入式事业群积极深化与嵌入式软硬件生态伙伴的技术联盟，串联全球不同垂直领域的系统集成商，打造多元、开放且对开发者友好的软硬件整合平台，加速各类 AI 技术在边缘场景的实际落地。



研华嵌入式物联网平台设计与服务

一站式嵌入式解决方案与设计服务

嵌入式软件服务



yocto
PROJECT



Windows

- 嵌入式BIOS和LTS操作系统
- SUSI软件API和操作系统锁定工具
- iManager: 智能自我管理芯片

WEDA: 边缘智能开发者架构



- AI 模型部署与管理
- 远程设备与数据管理
- 灵活适配云端与本地混合部署, 原生内置企业级安全防护
- 与 NVIDIA Omniverse 的无缝数字孪生集成



- 边缘 AI 开发平台
- 面向异构芯片的边缘AI与智能体AI开放框架
- 标准化物理 AI 集成框架
- IEC 62443-4-2 认证网络安全

软件与云集成

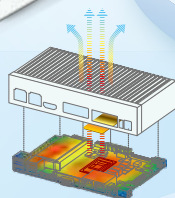


- Windows IoT操作系统
- Ubuntu操作系统
- 国产操作系统在 (统信/银河麒麟)
- Trellix白名单安全软件
- Acronis备份还原方案

载板设计



散热优化



intel AMD NVIDIA Qualcomm Rockchip NXP Texas Instruments 兆芯 Phytium 飞腾

全系列嵌入式平台

丰富I/O扩展



AI 加速模块



工业显示系统



存储, 内存, 无线模组



目 录

走进研华

研华简介	06
嵌入式技术创新	07
面向AIoT的全栈嵌入式解决方案	08
研华科技 — Edge AI 推动者	11
WEDA : 边缘智能开发者架构	12

嵌入式创新解决方案

研华嵌入式边缘 AI 解决方案	13
模型服务与边缘AI模型工程化部署平台	14
以 Arm 方案重新定义边缘技术	15
AIM-Linux 工业嵌入式软件平台	16
智能机器人行业全栈解决方案	17
机器人系统调优解决方案	18
光储充软硬一体解决方案	21
分布式边缘能源控制平台	22
研华智慧医疗解决方案	23
研华半导体测试解决方案	25

嵌入式硬件平台解决方案

工业主板	27
传统嵌入式单板电脑	29
MI/O 扩展型单板电脑	31
COM模块化电脑	33
RISC/Arm运算平台解决方案	37
EPC嵌入式工控机	41
ARK 无风扇工控机	43
DS 数字标牌解决方案	45

AIR 边缘 AI 推理系统 & 服务器	47
工业AI摄像头解决方案	49
工业存储与内存解决方案	51
工业显示解决方案	53
工业无线解决方案	55
无线电子纸解决方案	57

嵌入式软件服务

嵌入式操作系统	59
端到云的数据安全与综合防护解决方案	60

研华全球设计与制造服务

研华客制化设计与制造服务 (DMS)	61
客制化服务聚焦医疗行业	63
客制化服务聚焦国产“芯”	64
标准 Plus+客制化订购服务	65
研华生产规模 & 实力介绍	66
研华全球覆盖本地化支持&售后服务	67

研华嵌入式在线服务与橙悦客服

研华嵌入式在线服务	69
研华橙悦客服	70

ADVANTECH

Enabling an Intelligent Planet

始于 1983

总部：中国台湾

业务领域

工业4.0、工业物联网、嵌入式计算、医疗、零售、物流



92 市值
亿美元 (2026年2月)



荣誉 & 奖项

- 台湾全球品牌榜第五名
- 全球自动化厂商 50 强第 17 名
- 工业物联网百强企业第 9 名
- 红点产品设计奖
- iF 产品设计奖

Interbrand

CONTROL

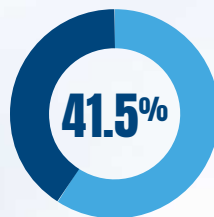


全球最大的IPC公司

研华IPC全球市场份额

- 研华
- 其它IPC公司

资料来源：OMDIA-工业PC市场份额估计：(全球数据，2025年版)



22.7 亿美元 2025 全球营收

重要生态合作伙伴



质量体系保障

- ISO9001
- ISO14001
- ISO13485
- ISO17025
- ISO27001
- ISO45001
- TL9000
- ISO50001
- RoHS
- WEEE
- SONY GP
- REACH

180 万+ 平方英尺

制造厂

中国台湾 - 林口



- 9 条自动贴片生产线
- 工程样品服务
- 丰富的产品线
- 灵活 & 快速生产

中国 - 昆山



- 12 条自动贴片生产线
- 底盘设计与生产
- 成熟的产品线
- 低成本高效益生产工艺



直方市(日本)

- 4 条自动贴片生产线
- 日本设计中心、CTOS 服务中心、物流中心、维修中心

全球分支机构



- 制造 3
- 现场服务 4
- 设计中心 11
- CTOS中心 16
- 维修中心 17
- 物流中心 20

全球90多家分支机构!

9494+ 雇员



推动嵌入式技术创新

研华一直致力于嵌入式技术的创新，确保客户能够获得市场上先进的解决方案。

技术

- x86 & RISC 架构
- GPU、FPGA、人工智能、无线
- 嵌入式控制器 & BIOS
- 高效散热方案

平台

- 嵌入式主板
- 嵌入式系统
- 嵌入式外围设备
- AI 加速模块

软件

- 嵌入式操作系统和 BSP
 - 安全设施
- 嵌入式 API 工具包
- 远程管理设备



面向 AIoT 的全栈嵌入式解决方案

研华意识到，在结合新兴技术提供解决方案时，不同行业面临的挑战都是不一样的。

我们将一系列新技术转化为多样化平台、行业内专属解决方案，从而满足客户的独特需求。



十余年可追溯项目数据提供背书，
我们的团队积累了大量跨职能经验。

专家小组

团队成员从业平均年限 5+

值得信赖的产品

我们的团队为各种外形的产品定制测试计划，并具备内部合规性评估能力。

管理实用程序

自有 4+ 认证
知识管理实用工具

验证设备

数以百万计的美元用于打造符合
ISO 标准的验证环境

在整个开发阶段，我们的团队可以有效解决产品问题，拥有可追溯的产品验证和认证结果。

确保提供
值得信赖的产品

AIoT 生态系统创新的推动者

连接 / 创建 / 共创

作为嵌入式市场的知名品牌，研华是连接整个生态系统的枢纽。结合顶尖技术合作伙伴的技术，我们开发各类产品和服务来推动整个工业领域的进步。我们不仅推动整个行业向前发展，还促进有效的市场沟通和信息传递，使我们能够向顶级技术合作伙伴提供市场需求反馈。这将鼓励我们的技术合作伙伴更上一层楼，继续开发创新技术。



研华科技 — Edge AI 推动者

硬件基石

软件加速

平台协同

ADVANTECH
WEDA

WEDA : 边缘智能开发者架构

跨平台互通

加速智能体开发

AI 全生命周期运维

高性能推理的
AI 模型

SKY 机柜服务器
5000+ TOPS



SKY 机柜服务器
2000+ TOPS



边缘端 AI 应用
推理解决方案

轻量级边缘AI推理系统
5~100+ TOPS



高性能边缘AI推理系统
300+ TOPS



服务器级边缘AI推理系统
1000+ TOPS



Edge AI
边缘模块

AI 核心模块
5~100+ TOPS



AI 主板
>500 TOPS



AI 加速模块
25~200 TOPS



Edge AI 配件
100+ TOPS



AI 运行环境

NVIDIA CUDA & TensorRT
Qualcomm Neural Processing
Intel OpenVINO
AMD ROCm
NXP eIQ
MeidaTek NeuroPilot
HailoRT

EdgeAI
SDK

AI 训练 & 推理

Edge Impulse
NVIDIA AI Enterprise
NVIDIA OmniverseTM
Microsoft Azure Open AI
Canonical MicroCloud

nvidia

Qualcomm

intel

AMD

NXP

HAILO

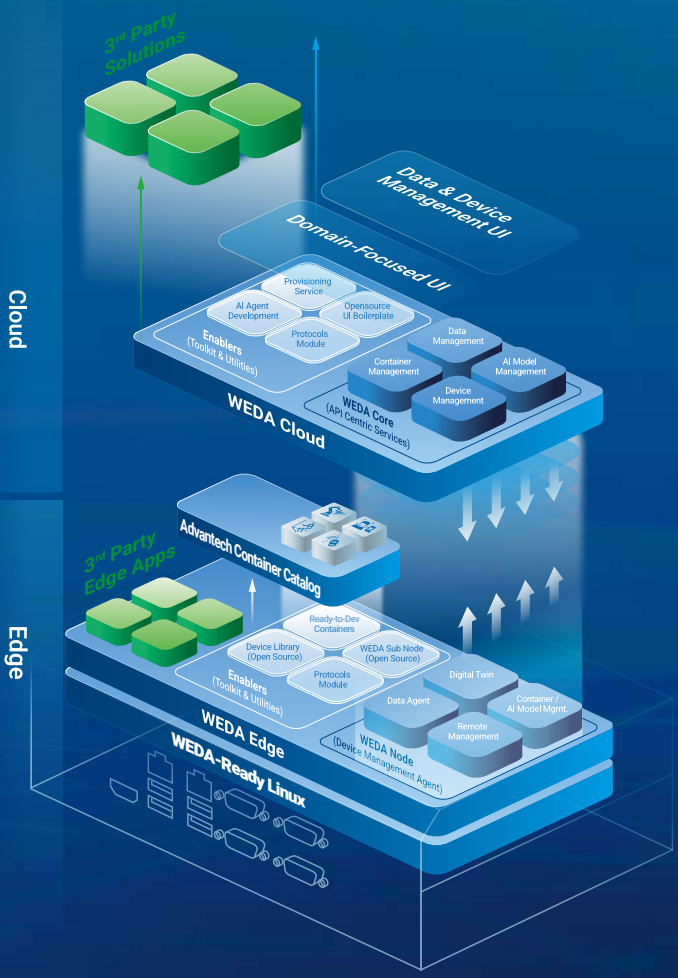
MEDIATEK

AXELERA

DEEPIX

加速 Edge AI 赋能工业应用

WEDA : 边缘智能开发者架构



- **Edge AI 全生命周期一体化管控**
统一规范 Edge AI 从开发、部署到运维的全流程环节
- **云边协同调度**
搭载数字孪生内核，打通云端调度能力与边缘端实际运行执行
- **可扩展容器化部署**
一次打包构建，即可适配多款异构硬件平台完成分发落地

容器仓库目录服务

WEDA SaaS 服务

WEDA 认证 Linux 配套服务

容器化架构设计

硬件抽象层

云边赋能

快速便捷部署



研华嵌入式边缘 AI 解决方案

边缘 AI 的应用场景极为广泛,需要多元的 AI 算力与工业级设计。研华与多家合作伙伴携手开发软硬一体的边缘 AI 解决方案,助力 AI 在机器人、工业自动化、智慧医疗、智慧零售及智慧城市等众多行业加速项目落地。



关键核心特性



垂直行业应用

可扩展 AI 系统
打造全面产品组合



视觉 AI 赋能

经过验证的 2D/3D 摄像头及视
觉 AI 解决方案配套系统



一站式软件加持

支持无代码图形界面与 API
简化 AI 应用开发



繁荣的生态共创

借力 AI 生态增值价值
降低应用门槛,缩短部署周期

模型服务与边缘 AI 模型工程化部署平台

重点客户快速、稳定、低门槛地将 AI 模型部署到目标 Edge 设备,同时也提供全栈式的服务加速AI应用在边缘工程化和规模化落地。



关键核心特性



AI模型算法定制

根据细分场景的业务需求
训练专属定制模型



场景算力与选型评估

综合考量场景要求,精准匹配
算力平台与模型方案



数据集调试与设计

高效添加标注拓展数据,
并针对场景调整数据集



推理性能优化

针对不同SoC特性
对模型工程适度调整



系统工程重构

系统性调度片上各加速单元,
整体优化工程项目

以 Arm 方案重新定义边缘技术

研华基于Arm计算平台方案,致力于塑造边缘智能的未来。在一个开放且创新的生态系统中,丰富标准化产品规格,并提供以开发者为中心提供长期服务支持。方案涵盖AI核心模块和板卡、可扩展的AI解决方案,以及简化部署的行业边缘系统。

✓ 实时

✓ 高性能

✓ 视觉AI

✓ 安全

✓ 低功耗



嵌入式操作系统

提供长期的操作系统 BSP 维护和在线资源,包括文档、应用程序附加组件和 SDK

yocto
PROJECT

Canonical
Ubuntu

debian

ANDROID
Android

QNX

Windows



软件工具包

增强兼容性,促进创新,提高边缘应用的性能

EdgeAI
SDK

Robotic
Suite

Power
Suite

DeviceOn

SUSI API



AI 就绪边缘系统



AI 核心模块与主板



行业应用系统

NXP

Rockchip

MEDIATEK

Qualcomm

TEXAS
INSTRUMENTS

NVIDIA

ALLWINNER
全志科技

AIM-Linux 工业嵌入式软件平台

AIM-Linux 是一套云原生的多合一工业级嵌入式 Linux 软件平台，通过统一开放的软件平台架构与行业深耕的技术积累，帮助医疗、新能源、仪器仪表、通信、轨交、航运及生产制造等关键行业设备厂商抹平底层技术差异，聚焦应用场景开发，实现设备与系统的快速开发与规模化落地。



赋能行业：医疗、新能源、仪器仪表、通信、轨交、航运、生产制造



设备上云



安全 OTA



一站式部署



跨架构属性



痛点解决服务



开源BSP

智能机器人行业全栈解决方案

研华打造端到端机器人 AI 解决方案,从边缘算力底座到传感器融合技术,从成熟开发套件到全流程设计协助,全方位降低机器人 AI 开发门槛,助力企业快速实现从原型验证到规模化部署的跨越,解锁工业、物流、特种场景下的智能升级新可能。

Robotic Suite

Senso
Node



Sensing
Pereption



Visual
Pereption



Industrial
Protocol



AI Accelerate
SDK



SLAM
& Map Data



Path
Planning



Navigation
& Localization



nvidia intel Qualcomm

无人机



AMR



机械臂



四足机器人



工业传感器



工业无线模块



工业显示屏



机器人系统调优解决方案

面向机器人量产落地的机器人系统优化与板级集成方案。从 Linux 内核 / BSP / 驱动 到 ROS2 中间件与加速链路一体化打通,交付可验证、可扩展、可量产 的机器人软件底座。



AFE 系列



AFE-R360

- 新一代Intel处理器, 高达14核, TDP 28/15W
- 双通道 DDR5-5600
- 通过samtec 120Pin B2B连接器支持MIPI-CSI
- 支持3 x LAN, 5 x USB (incl. 1x USB4), 4 x UART, 2 x CAN-FD
- 支持4 x 扩展口: M.2 E-Key, B-Key, 2 x M-Key (支持 NVMe)



AFE-R770

- 支持Intel第12代 & 第13代 & 第14代酷睿 i3/i5/i7/i9处理器
- 机器人专用隔离I/O: 4 x 2.5GbE, 4 x USB3.2, 2 x CANBus, 4x RS-232/422/485, 16 位 DIO
- 9~36VDC, 可切换点火/PC 开机模式



AFE-R760

- Intel Core Ultra 7/5 处理器, 高达16核, TDP 28W
- 通过120 pin B2B连接器支持4x GMSL
- 专用I/O用于AMR: 3x 2.5GbE, 2 x USB-C, 2 x USB-A, 4 x COM, 2 x CAN-FD, 8xGPIO



AFE-R750

- AMR AI控制系统, 可达275 TOPS AI计算能力
- 专用机器人接口: 4xGbE, 2xCOM, DIO, CANFD
- 摄像头, 激光雷达, IMU等传感器连接
- 支持 Ubuntu 22.04, JetPack 6.1SDK



AFE-A702

- 搭载NVIDIA Jetson T5000 加速处理器, 提供高达2070 TFLOPS FP4推理性能
- 专为机器人设计的I/O接口: 6 x GbE, 4 x USB, 2 x COM, DIO, CANFD
- 支持QSFP28 1 x 25GbE

ASR 系列



ASR-A502

- Intel Core Ultra处理器, 最高可达 96 TOPS, 热设计功耗(TDP)28 瓦
- 双通道 DDR5-5600 内存, 最高支持 96GB
- AMR专用 I/O 接口: 3个千兆以太网口, 7个 USB 接口(包括 3个 USB-C 接口), 4个COM 接口, 2个 CANFD 总线
- 4个扩展接口: M.2 E-Key 接口, B-Key 接口, 2个 M-Key 接口(支持 NVMe协议)



ASR-A701

- AMR AI 控制器板, 最高支持 275 TOPS AI 计算能力
- 专为 AMR 设计的专用 I/O 接口: 4个以太网端口, 2个串口, DIO接口, CANFD 接口
- 支持连接摄像头, 激光雷达, 惯性测量单元(IMU)等传感器



AFE-A702

- 搭载NVIDIA Jetson T5000 加速处理器, 提供高达2070 TFLOPS FP4推理性能
- 专为机器人设计的I/O接口: 6 x GbE, 4 x USB, 2xCOM, DIO, CANFD
- 支持QSFP28 1 x 25GbE



AFE-R360 开发套件

- Intel Core Ultra 125H处理器, 合并算力 高达32TOPs
- 支持3路LAN, 7路USB, 4路高速COM, 2路CAN FD
- 支持12-24V直流供电, 高ESD防护 放电: 8KV 空气放电:15KV
- 内置4路MIPI-CSI/GMSL摄像头解决方案



ASR-A701DVK 系列

- AMR AI 控制器主板, 最高支持100 TOPS算力
- 专为AMR设计的专用I/O接口: 4 x GbE, 2 x COM, DIO, CANFD
- 内置4路GMSL摄像头解决方案

核心板系列



AOM-3821

- 瑞芯微RK3588 Arm 四核 Cortex-A76 2.4GHz 和四核 Cortex-A55 1.8GHz
- 板载4/8GB LPDDR4内存和32/64GB eMMC
- 支持 HDMI, DP, eDP 和 HDMI IN
- 4 x PCIe3.0, 2 x GMAC, 2 x USB3.0, Type C, 2 x PCIe2.0/SATA3.0, 2 x MIPI-CSI, UART



AOM-5841

- 瑞芯微RK3576 Arm 4xCortex-A72 2.2GHz 和4 x Cortex-A53 2.0 GHz
- 板载 4/8 GB LPDDR5 内存 和32/64 GB eMMC
- 支持HDMI, DP and 1 x 4 lane MIPI-DSI
- 1 x PCIe 2.1, 1 x USB3.2 Gen1, 1 x US8 2.0 OTG, 3 x UART
- 2 x GbE, 2 x CAN-FD, SDIO, 2 x MIPI-CSI



SOM-6884

- 第13代 Intel Core 处理器
- COM Express R3.1 Compact规范, Type 6 Pin定义
- 双通道内存, 高达64GB, 4800MT/s
- 高速 I/O: 16 x PCIe Gen4, 8x PCIe Gen3, 2 x USB4 & 4 x USB3.2 Gen2
- 支持 SUSI, DeviceOn 和 Edge AI 套件



SOM-7533

- COM Express R3.1 Mini 模块 Type 10 引脚
- Intel Core-i/Pentium/Celeron和Atom x 7000 系列处理器
- 单通道LPDDR5 4800MT/s高达16GB, 支持 IBEC
- 2.5 GbE支持TSN
- 丰富I/O扩展: PCIe gen3, USB3.2 Gen2, SATA3.0



SOM-M250

- COM-HPC Size Mini 模块
- Intel Core Ultra 处理器, 高达 16C
- Intel Xe3 显卡高达 196EU, 3 个独立的 4K 显示
- LPDDR5 6400MT/s 高达 64GB
- 丰富 I/O 扩展: 2.5GbE、PCIe Gen5、USB4 & USB3.2 Gen2、SATA3.0

摄像头解决方案



CAM-5530-U

立体视觉摄像头

- USB3 接口
- Depth: 1M(1280x800) / 30fps
- RGB: 1M(1280x800) / 30fps
- Depth: 94° (H) x 62° (V) ± 3° @ 2m(全局快门)
- RGB: 94° (H) x 68° (V) ± 3° (全局快门)
- 尺寸 : 124 x 29 x 27.7mm



CAM-5530-G

CAM5530 GMSL2 立体视觉摄像头

- GMSL2
- Depth: 1M(1280x800) / 30fps
- RGB: 1M(1280x800) / 60fps
- Depth: 90° (H) x 65° (V) ± 3° @ 2m(全局快门)
- RGB: 94° (H) x 68° (V) ± 3° (全局快门)
- 尺寸 : 124 x 29 x 36mm



CAM-5330-U

CAM5330 USB 3.0 立体视觉摄像头

- USB3 接口
- 深度模式 : 1M(1280x800) / 30fps
- RGB 模式 : 2M(1920x1080) / 30fps
- Depth: 90° (H) x 65° (V) ± 3° @ 2m(全局快门)
- RGB: 86° (H) x 55° (V) ± 3° (滚动快门)
- 尺寸 : 90 x 25 x 30.7mm



CAM-2210-G

CAM-2210 GMSL2 工业摄像头

- 索尼 IMX335 传感器, 支持 ISPi(YUV)
- GMSL2 接口
- 5M(2560x1920) / 30fps
- M12 / F1.6 / 130.7° (D) x 100° (H) x 73.4° (V), 滚动快门



CAM-2220-G

CAM-2220 GMSL2 工业摄像头

- ONSEMI AR0234 + ISPi(YUV)
- GMSL2 接口
- 2.3M(1920x1200) / 60fps
- M12 / F1.8 / 113.4° (D) x 95.8° (H) x 59.6° (V), 全局快门
- 尺寸 : 29 x 39.5 x 55.7mm

光储充软硬一体解决方案

研华工业级储能边缘网关以丰富接口，带隔离保护和宽温设计在储能场域稳定运行，支持标准EMS及合作开发，助力快速部署集成。

能源设施管理

可再生设施大多部署在广阔区域，导致管理困难。连接到一个易于访问、可扩展且能及时响应的管理平台，可确保其可用性。

软硬一体化

工业级储能网关结合研华EMS软件合作开发，降低系统集成难度，缩短方案开发周期，方便项目迁移更新。

高可靠设计

用于户外应用的控制和通信设备必须能够承受恶劣环境的考验。工业级设计应对温度、振动、腐蚀性气体及污染物等挑战，以确保稳定运行。

网络安全认证

在设备连接互联网的过程中，网络攻击问题一直备受关注。IEC62443 发挥着重要作用，引导设备制造商制造更安全的产品。

EMS软件合作开发

通过开放API与SDK，使厂商可自主开发前端与业务策略。支持削峰填谷 / 负载均衡 / 充放电控制策略，快速部署户用与工商业场景。



AFE-E630
储能边缘智能网关

Rockchip RK3568J



AFE-E620
储能数据采集网关

全志T536



AFE-R770
储能场站管理设备

Intel 14th Gen Core i3/i5/i7/i9



AFE-E420
嵌入式单板电脑

NXP i.MX93

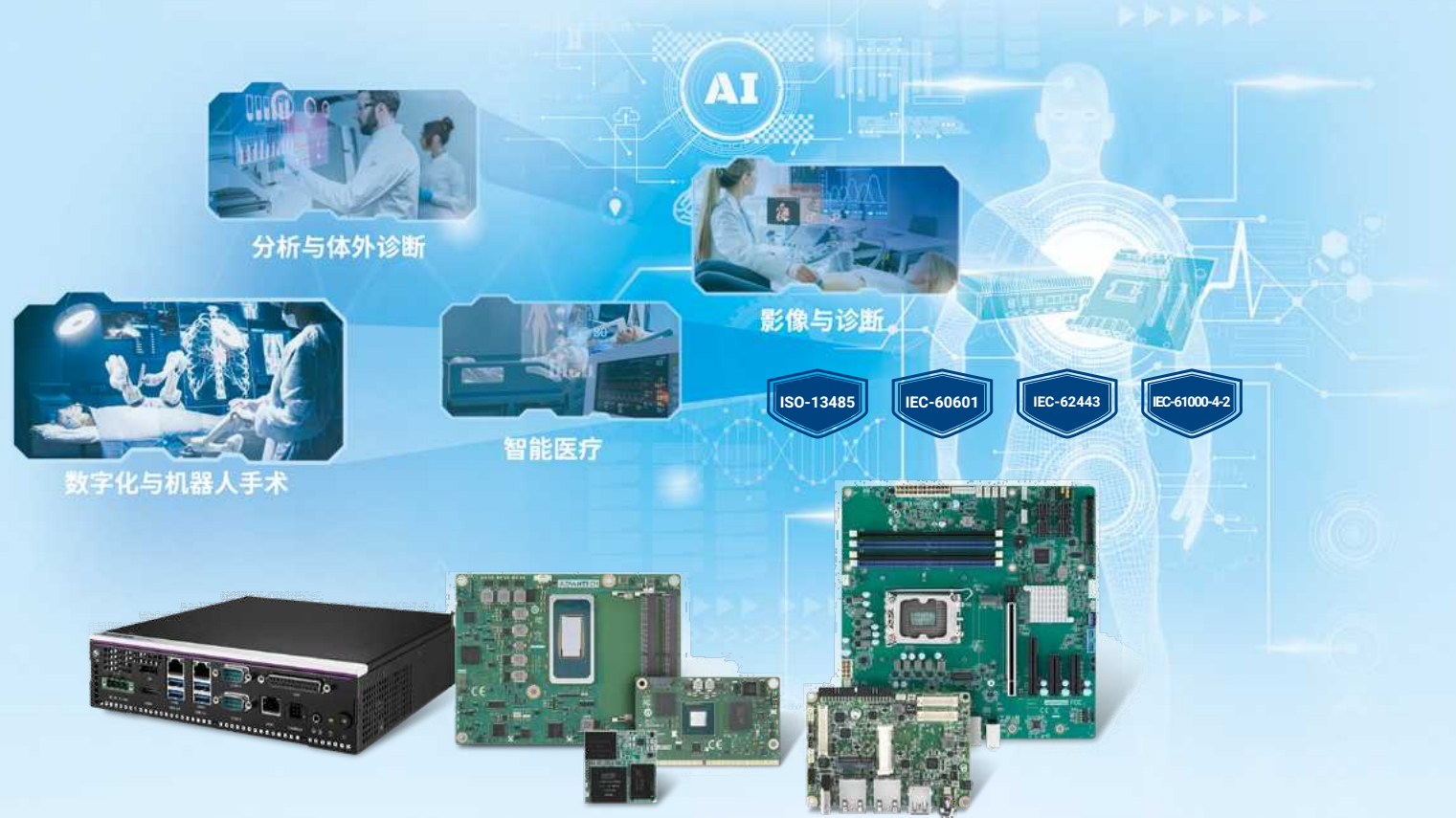
分布式边缘能源控制平台

研华本地端能源管理软件是面向分布式能源系统的边缘能源控制平台。通过开放架构平台与本地自治控制能力,帮助客户实现能源资产统一接入、策略高效编排执行与系统持续演进,让能源系统从一次性交付走向可复制的规模化能力。



研华智慧医疗解决方案

研华科技已深耕医疗行业二十多年，致力于为医疗设备厂商提供专业解决方案。随着物联网的兴起，研华开始提供智慧医院管理解决方案，帮助医院实现全面的数字化转型。多年来，研华凭借其在工业领域的深厚积累和不断创新，逐渐成长为医疗数字化和智能化的重要推动者，持续赋能医疗行业高质量发展。



内窥镜系列



SOM-6873

- AMD Ryzen 嵌入式 4nm SoC – 8000 APU
- COM Express R3.1 Compact 模块 Type 6 引脚
- 双通道 DDR4 SODIMM, 高达 96GB
- 高速 I/O: 2 USB 3.2 Gen2, 1 PCIe x8 Gen3, 6 PCIe x1 Gen3, 4 SATA3.0
- 4显示 (DP++, HDMI, VGA, eDP)
- 支持 iManager, 嵌入式软件 API 和 DeviceOn



SOM-6833

- COM Express R3.1 Compact Type 6 模块
- Intel Core-i/Pentium/Celeron和Atomx7000 系列处理器
- 单通道DDR5 4800MT/s 高达16GB, 支持IBECC
- PCIe Gen3、USB3.2 Gen2、SATA3.0、2.5GbE 支持TSN
- 板载eMMC (可选)



AIMB-2210

- 支持AMD Ryzen 8000系列CPU, 内置 XDNA NPU, 整体算力高达36Tops
- 独立四显: 4xDP/LVDS/eDP, 最高可达4K
- 1xPCIe x8 Gen3, 2 x GbE LAN, 3 x USB 3.2 Gen2, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 6 x COM, 2 x M.2, 2xSATA III
- 支持SUSI, WISE-DeviceOn和Edge AI Suite

超声系列



SOM-2533

- Intel Core-i/Pentium/Celeron 和 Atom x7000 系列处理器
- 单通道 LPDDR5 4800MT/s 高达16GB, 支持 IBECC
- 独立三显, 支持4K/2K (DP++, HDMI, LVDS/eDP/MIPI-DSI)
- 丰富的I/O扩展: PCIe gen3, USB3.2 Gen2, SATA, CAN-bus



SOM-5886

- COM Express R3.1 Basic模块, Type 6 引脚
- Intel Core Ultra 处理器(下一代), 高达 16C/20T
- Intel Xe LPG图形高达192EU, 4个独立4K显示屏
- 整合NPU、GPU与CPU, 提供高达 180 TOPS 的 AI 算力
- 双通道 DDR5-6400MT/s 高达128GB SODIMM

手术机器人系列



SOM-C350

- COM-HPCC Client C尺寸模块
- Intel Alder Lake-S桌面插座型CPU
- 16核, 24线程, 65W TDP
- 双通道DDR5 SODIMM, 高达128GB (ECC可选)
- 16 PCIe Gen5, 6 PCIe Gen4, 10 PCIe Gen3
- 支持iManager, 嵌入式软件 API 和 DeviceOn



ASR-A502

- Intel Core Ultra处理器, 最高可达 96 TOPS, 热设计功耗(TDP)28 瓦
- 双通道 DDR5-5600 内存, 最高支持 96GB
- AMR专用 I/O 接口: 3 个千兆以太网口、7 个 USB 接口(包括 3 个 USB-C 接口)、4 个COM 接口、2 个 CANFD总线
- 4 个扩展接口: M.2 E-Key 接口、B-Key 接口、2 个 M-Key 接口(支持 NVMe协议)



AOM-6731

- Snapdragon X1 Elite12 核, 高达3.4GHz
- 16GB LPDDR5x, 128GB UFS 和 1x 4-bit SDIO 用于 SD 卡
- Andreno Snapdragon X GPU 支持 DX12.2、OpenGL ES 3.2 和 OpenCL 3.0
- 1x DP, 1x eDP
- Adreno VPU 第五代, 4K60P 编解码器, 支持 H.264/HEVC/VP9



ROM-5880

- 基于瑞芯微 RK3568 四核 Cortex-A55, 高达2.0GHz
- 搭载1 TOPS AI算力 NPU
- 板载 2/4GB LPDDR4 内存和 16/32GB 存储
- 支持 1x HDMI2.0 4K, 1 x signal LVDS或1 x 2ch MIPI DSI或1 x edp
- 支持 4K H.264/H.265 视频解码



MIO-5854

- 基于Intel Twin Lake 平台, 支持 6/15W TDP DDR5-4800 高达 16GB
- 丰富I/O: 4 x LAN, 4 x USB, 4 x UART, 2 x CAN-FD, 16位 GPIO, I2C/SMBus
- 2 x M.2 扩展: E-Key 2230, B-Key 2280
- 支持 EdgeBMC 进行 OOB(带外)远程控制

研华半导体测试解决方案

半导体检测设备面临的主要挑战在于对精度、稳定性和扩展性的极高要求。随着制程技术的不断进步,对硅片表面和晶体缺陷的检测标准越来越严格,对检测设备的性能也提出了更高的要求。研华提供从嵌入式主机到高阶AI平台的全方位解决方案,确保满足半导体测试设备对精度的极致追求。产品历经严格验证,保障设备长期稳定运行,有效减少故障与误差积累。同时,针对设备小型化趋势,推出高效能、小体积产品,实现性能与体积的平衡,助力客户应对技术升级,保障产品质量。



可扩展规格形态



灵活 AI 能力



远程管理



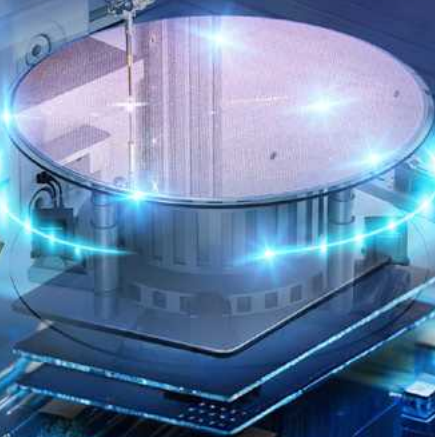
高带宽传输



无风扇坚固设计



网络安全



intel

AMD

HYGON

MEDIATEK

Qualcomm

Rackchip

核心板系列解决方案



SOM-5885

- COM Express R3.1 Basic 模块 Type 6 引脚
- Intel 第14代Core处理器, 高达14C/20T
- Intel Xe LPG图形高达128EU, 4个独立4K显示屏
- 双通道DDR5 5600MT/s 高达96GB SO-DIMM



SOM-6874

- COM Express R3.1 紧凑型模块, Type 6 引脚定义
- 搭载AMD Ryzen AI 嵌入式P100处理器, 高性能Zen 5C/Zen5c 架构CPU, 高达12核/24线程
- 集成AMD Radeon RDNA 3.5 显卡, 支持4路独立4K 显示输出
- 集成AMD XDNA 2 NPU, AI 算力高达50 TOPS



SOM-7533

- COM Express R3.1 Mini 模块 Type 10 引脚
- Intel Core-i/Pentium/Celeron和Atom x 7000系列处理器
- 单通道LPDDR5 4800MT/s高达16GB, 支持IB ECC
- 2.5 GbE支持TSN



SOM-E781

- AMD EYPC 8004 服务器级 CPU, 高达64C/200W, 性能出色
- 高达576GB 大内存, 带6个DDR5 RDIMM
- 79路PCIe Gen5, 包括48路CXL1.1
- 丰富I/O 扩展: 2.5GbE、USB3.2 Gen1、SATA3.0



SOM-C350

- COM-HPC Client C尺寸模块
- Intel Alder Lake-S桌面插座型CPU
- 16核, 24线程, 65W TDP
- 双通道DDR5 SODIMM, 高达128GB (ECC可选)
- 16 PCIe Gen5, 6 PCIe Gen4, 10 PCIe Gen3

主板 & 整机系列解决方案



AIMB-523

- 支持AMD Ryzen AM5 7000系列处理器和B650芯片组
- 独立三显: DP/2 x HDMI
- 支持PCIe x16 Gen5, PCIe x4 Gen4, PCIe x1 Gen4
- 支持6 x 2.5GbE LAN, 8 x USB 3.2, 4 x SATAIII, 4 x COM, 1 x M.2 M key
- 支持DeviceOn和嵌入式软件API



AIMB-589

- 支持Intel Ultra Series 2 5/7/9处理器与Q870/W880芯片组
- 4 x U-DIMM, 最高可达192GB DDR5 5600MHz SDRAM
- 支持1 x PCIe x16 Gen5, 2 x PCIe x4 Gen4, 1 x USB Type-C, 6 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, 8 x SATA III, 2 x GbE LAN, 2 x 2.5GbE LAN, 6 x COM, 2 x M.2 M key, 1 x M.2 E key



AIMB-279

- 搭载12/13/14th Gen Intel Core 处理器 (LGA1700), 最高可达24核; 兼容Q670E/H610E 芯片组
- 双通道DDR4 3200MHz 内存, 配备双SODIMM 插槽, 最大支持64GB 容量
- 高速I/O 配置: PCIe x16 Gen4(16GT/s)、USB3.2 Gen2(10Gbps)、2.5G 千兆网口
- 支持四屏独立4K 显示输出, 配备2路DP1.4、1路HDMI及1路LVDS 接口



ARK-1125H

- Intel 处理器 N-series N200 QC SoC
- DDR5-4800 SO-DIMM 内存支持最高16G
- 双HDMI独立显示支持4K分辨率
- M.2 E Key, B Key 和 M Key 用于存储和无线模块安装
- TPM系统安全选项
- 支持宽温运行-30 ~ 60 °C



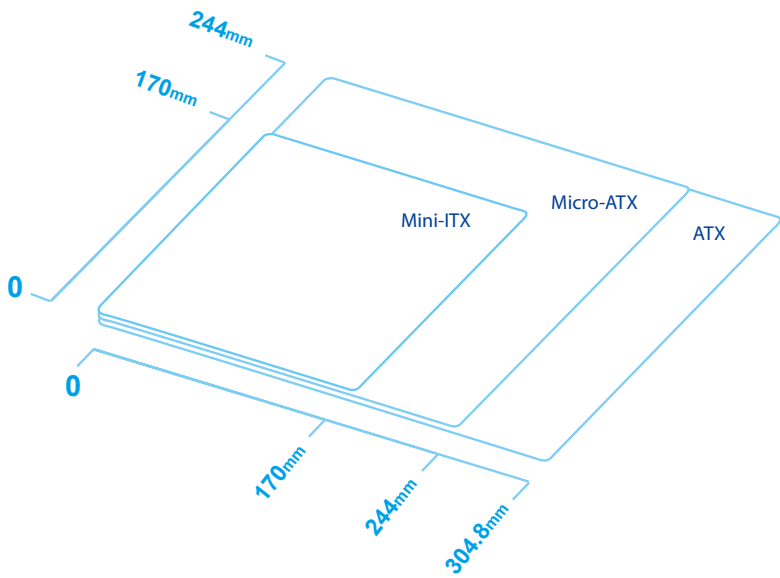
ARK-1251

- Intel Core Ultra 5/Ultra 7 处理器
- DDR5-5600 SO-DIMM 内存支持最高96G
- M.2 E Key, B Key 和 M Key 用于存储和无线模块安装
- 高达3 x Intel GbE, 4 x serial ports, 8-bit DIO, 可选配CANBus
- 双显 1 x 8K HDMI + 1 x 4K DP
- 2 x USB 3.2和4 x USB 2.0

工业主板

随着物联网应用需求的不断增长，嵌入式市场趋向于边缘端高性能计算与高密度计算应用。研华工业级主板系列涵盖Mini-ITX、MicroATX到ATX等规格，从入门级到服务器级全方位产品覆盖，支持客制化与提供完整的嵌入式设计和Design-in整合服务，可加速物联网设备部署，增加产品差异化价值，帮助客户取得市场先机。

工业主板主要规格介绍



多样化产品

- 从入门级到服务器级别
- 覆盖Intel & AMD平台
- Mini-ITX, Micro-ATX 标准工业主板设计尺寸



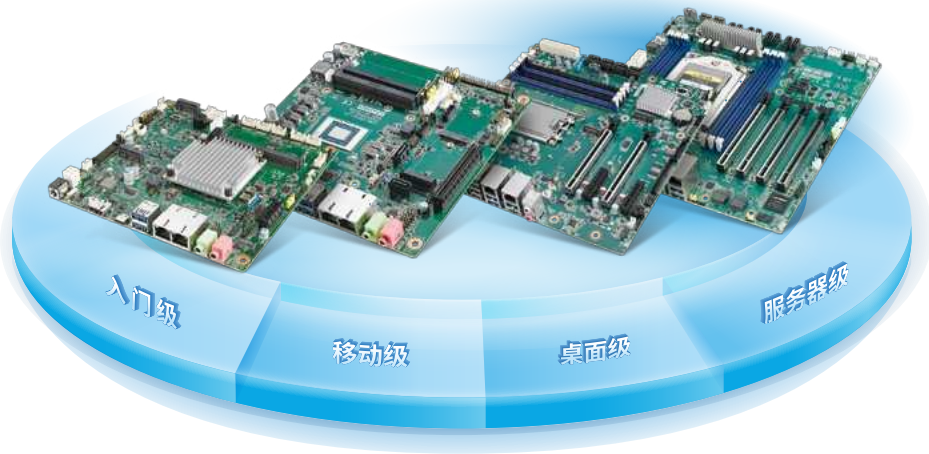
灵活集成

- 多种扩展
- 外围集成
- 附件兼容



内置智能软件

- 嵌入式BIOS
- 客制化软件
- 研华 **WISE-PaaS/EdgeSense**



Mini-ITX系列工业主板

Mini-ITX 工业级主板采用尽可能减少空间占用的设计原则，其尺寸只有 170 x 170 mm，并能够提供丰富的接口以及可靠的效能。薄型Mini-ITX系列产品高度仅为25mm，满足不同行业应用需求。



AIMB-208

- 支持Intel 第12/13/14代 Core i系列处理器和H610E芯片组
- 2 x DIMM, 最高可达64GB DDR4 3200MHz
- 独立三显: 2 x DP/HDMI/LVDS



AIMB-219

- 板载Intel 第12代 Core i N系列
- 独立三显: DP/HDMI/LVDS/eDP(可选)
- 支持1x PCIe x1, 2x M.2, 6x COM, 8x USB, 2 x 网口
- 12V DC-in供电设计



AIMB-2210

- 支持AMD Ryzen 8000系列CPU
- 内置XDNA NPU, 整体算力高达36Tops
- 独立四显: 4 x DP/LVDS/eDP, 最高可达4K
- 支持1x PCIe x8, 2 x GbE, 8 x USB, 6 x COM, 2 x M.2



AIMB-2710

- 支持Intel Ultra Series 2 5/7/9处理器与Q870/H810芯片组
- 独立四显: DP/HDMI/eDP/LVDS
- 支持1 x PCIe x16 Gen5, 2 x M.2, 10 x USB, 1xType-C, 2 x 2.5GbE



AIMB-289

- 支持Intel 第12/13/14代 Core I 处理器和H610E芯片组
- 支持三显: HDMI/DP/LVDS
- 支持1x PCIe x4 Gen3, 3 x 2.5GbE, 2 x M.2, 4 x COM, 4 x USB
- 支持12~24V宽压输入

Micro-ATX系列工业主板

Micro-ATX 工业主板具有与 ATX 主板相同的高度整合能力，尺寸为 244 x 244 mm。主要特点为高性价比、长供货周期、扩展能力强、高性能。



AIMB-508

- 支持Intel 第12/13代 Core i处理器和H610E 芯片组
- 支持三重显示: HDMI/DP/eDP/LVDS
- 支持PCIe x16 Gen4, PCIe x4 Gen3, 2 x PCI, 14 x USB, 10 x COM



AIMB-589

- 支持Intel Ultra Series 2 5/7/9处理器与Q870/W880芯片组
- 独立四显: HDMI/2xDP/eDP
- 支持1x PCIe x16 Gen5, 2x PCIe x4 Gen4
- 支持1xType-C, 12xUSB, 8xSATA III, 2 x GbE, 2 x 2.5GbE, 6 x COM, 3 x M.2



AIMB-592

- 支持AMD EPYC 7003系列处理器
- 支持4 x PCIe x16 Gen4, 2 x PCIe x4 薄型SAS
- 支持5 x USB 3.2 Gen1, 8 x SATA III, 2 x 2.5GbE LAN, 2 x 10GbE LAN, 1 x BMC LAN, 1 x COM, 1 x VGA



AIMB-288E

- 支持Intel 第12/13/14代 Core i处理器与H610E芯片组
- 搭载NVIDIA Quadro 嵌入式级别T1000/A500/A2000 MXM显卡或Intel Arc A370M MXM显卡
- 2 x SODIMM, 最大支持64GB DDR5 4800MHz



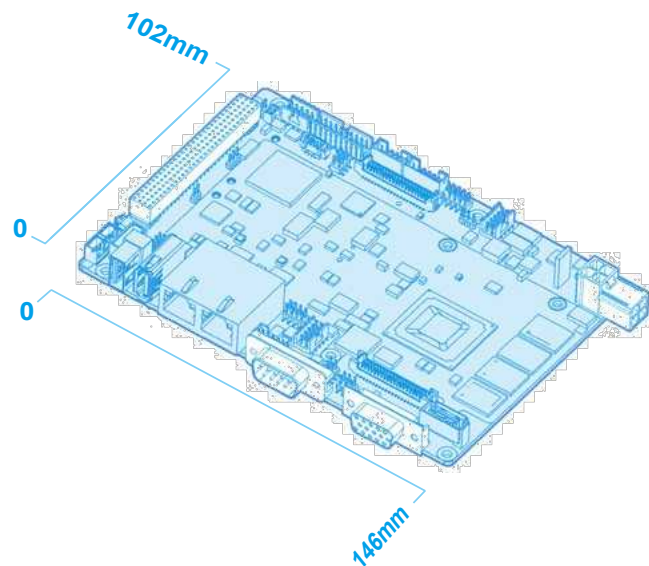
AIMB-294

- 支持Armv9架构 Neoverse V3AE系列处理器
- 搭载NVIDIA Jetson T4000/T5000模组, 最高可达2560 Core
- 独立双显: DP/HDMI, 高达4K分辨率
- 支持1 x M.2 M key, 1 x M.2 B key, 1 x M.2 E key, 4 x USB 3.2, 1 x USB Type-C, 2 x COM, 2 x GMSL, 4 x 25GbE QSFP28E1 x 5GbE LAN

传统嵌入式单板电脑

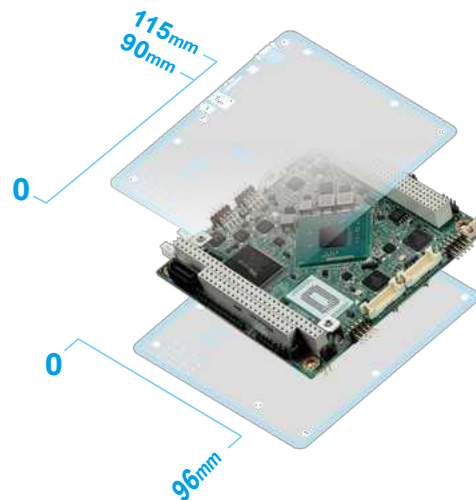
研华嵌入式单板电脑(ESBC)提供2.5" Pico-ITX、3.5" SBC、4" EPIC、PC/104规格尺寸,提供从入门 Atom 系列到Intel Core i7 的全系列产品,搭载丰富功能及接口,如带有隔离的CANbus、高速多串口、2-24V宽压、-40~85°C宽温及板载内存 & 存储等。其中,传统的PCM嵌入式单板电脑可以提供PC/104、PCI-104等扩展接口,方便客户扩展多样的模块,以满足不同应用的需求。

传统嵌入式单板电脑主要规格介绍



传统3.5" 单板电脑特点

- 两种传统扩展接口: PCI-104, PC/104
- 全面性能覆盖, 支持第四代到第六代Atom产品
- 采用丰富I/O接口, 具备高灵活性、无风扇设计和工业宽温



PC/104 CPU 模块特点

- 支持PC/104-Plus扩展
- 支持Lx800 至Intel Atom Baytrail CPU平台
- 支持宽温, 高振动/冲击耐受度(符合MIL-STD标准)

传统3.5" 单板

3.5" 单板电脑具备小尺寸、无风扇、低功耗、高效能等特性，同时该系列单板电脑支持Intel Atom 第四代至第六代的产品，可满足客户各种应用场景的需求。



PCM-9310

- Intel 第五代Atom 平台
- DDR3L-1066MHz SODIMM, 高达8GB
- 独立三显: VGA + HDMI + LVDS/eDP*
- 丰富I/O: 4 COM, 2 SATA, 2 USB3.0, 4 USB2.0
- 高性价比



PCM-9366

- Intel 第六代Atom平台
- DDR3L-1600/1333 SODIMM, 高达8GB
- 独立三显: VGA+LVDS/eDP+HDMI/DP*
- 丰富I/O: 4 COM, SATA, USB3.0, SMBus/I²C, 2 CANBUS
- 支持9~36V宽压输入



PCM-9365

- Intel 第四代 Atom 平台
- 支持2GB/4GB板载内存
- 独立三显: VGA+LVDS/HDMI+LVDS
- 支持 PCI-104扩展
- 丰富I/O: 2 LAN, 4 COM, SATA, 6 USB
- 支持-40~85°C宽温

PC/104 CPU 模块

PC/104是一个国际标准,其堆栈式的扩展方式是一种应用广泛,可靠坚固,性价比高的嵌入式解决方案。凡是PC/104产品,必须符合标准的设计规范,其大小、高度、固定方式都有严格的规定。



PCM-3365

- Intel 第四代Atom平台
- DDR3L-1066/1333MHz SODIMM, 高达 8GB
- 支持 PC/104-Plus 扩展
- 独立双显示, 1 LAN, 6 USB

MI/O 扩展型单板电脑

研华MIO扩展型单板电脑，是传统嵌入式单板电脑的升级。

MIO 单板电脑，支持MIOe 的扩展，继承了传统PC/104 层叠式紧凑扩展优点，但同时其扩充性大大的提升。通过MI/O Extension接口(MIOe)连接MI/O Extension模块后，客户即可拥有更多灵活的I/O选择，从而满足垂直应用的各种需求。

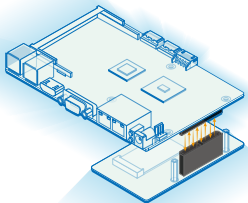
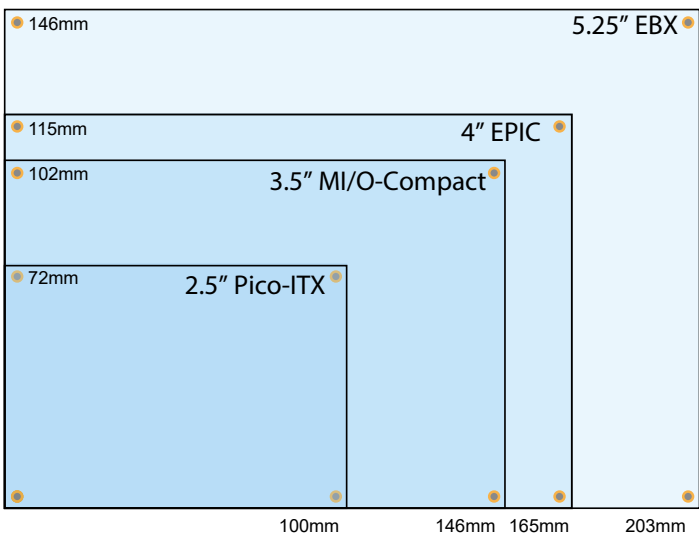
当然，随着应用场景需求的不断发展，在最新的MIO单板上面，也逐渐使用M.2 扩展接口来替代MIOe扩展。



为什么选择MIO?

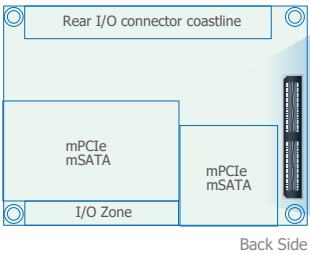
- 集成嵌入式常用功能信号，加快产品开发
- 优化的单面集中散热设计，适应宽温环境
- 多样化的MIOe扩展模块，实现无线缆设计
- 统一的安装孔位与I/O位置，便于系统集成

MI/O 扩展型单板电脑主要规格介绍



突破PC/104的局限，MIOe支持以下扩展：

- DP
- 4 PCIe x1
- LPC
- SMBus
- USB/Audio



MIOe 针脚定义

- DisplayPort
- 4 PCIe x1
- USB 3.0
- USB 2.0
- LPC
- HD Audio 输出
- SMBus
- +12V/ +5V Power

2.5" PICO-ITX MIO

MIO PICO-ITX 系列单板电脑可支持 AMD G 系列至Intel Atom 第六代处理器, 单板尺寸与2.5" 硬盘相同, 主要适用于 X86低功耗及尺寸要求较高的应用场景。

NEW



MIO-2364 高性价比 & 边缘应用

- Intel Core i3-N305, N97及x7221E
- DDR5-4800 高达16GB
- 双独立显示: LVDS + HDMI
- GbE (可选PoE/PD, 802.3at), 4 USB, COM, SMBus/I²C

NEW



MIO-2363 紧凑坚固 & 抗振宽温

- Intel Atom 第八代系列处理器
- 板载LPDDR4x最大8GB, EMMC 高达128GB
- 支持12~24V宽压, -40~85°C宽温
- 2 GbE LAN, 2 USB3.2, 2 RS-232/422/485, I²C

NEW



MIO-2375 名片大小 & 高AI算力

- Intel第11代CPU (10nm++), 板载内存LPDDR4x 高达32GB
- 独立双显: eDP/MIPI-DSI+DP, 分辨率高达8K
- 丰富I/O: 双GbE, USB3.2, COM, DIO, TPM2.0
- 灵活扩展: M.2 E-Key, M.2 B-Key/M-Key NVMe x2

4" MIO

创新4英寸规格MIO嵌入式单板电脑, 支持Socket Core 十二/十三代 i3至i9级别 35W TDP CPU。

NEW



MIO-4370 灵活性能选择 & 丰富扩展

- 第十二代Intel Core处理器, 高达16核, TDP 35W
- 灵活socket CPU (LGA1700)并支持标准风扇散热
- DDR5 4800高达32GB, 3独立显示: 双HDMI+eDP
- 双高速2.5G以太网与TSN, 2x COM, CANbus, TPM
- 双 M.2 M-Key(支持NVMe), M.2 E-Key 扩展

3.5" MIO

3.5" MIO系列支持宽性能覆盖, 可支持Intel Atom系列 至 Core i7/Xeon系列 处理器, 同时具备宽温宽压, 无风扇散热, 垂直行业应用及MIOe弹性扩展等特性, 可满足客户严苛的工业应用需求。

NEW



MIO-5154 高性价比 & 丰富I/O

- Intel 12代Core i3-N305/N97 /N50
- 单通道 DDR5-4800 高达 16GB
- 独立3显示: LVDS + HDMI + DP
- 2 GbE, 6 USB, 6 COM, SMBus/I²C
- 丰富扩展: M.2 E-Key 2230, M.2 B-Key 2280 & 3052



MIO-5379 高性能 & AI应用

- Intel Core Ultra 2代处理器, 多达 14 核, TDP 28W/15W
- 双通道 DDR5-6400, 高达 96GB, 支持 IBECC
- 4个独立显示: eDP + 2x HDMI + USB-C (DP)
- 2x LAN, 8x USB(包括 1x USB4), 4x UART, 2x CAN-FD, 8位 GPIO, I²C(*SMBus)
- 4个M.2 扩展: E-Key 2230, B-Key 3052, 2x M-Key 2280

NEW



MIO-5854 高性价比 & 丰富功能

- 基于Intel Twin Lake 平台, N355/150支持6/15W TDP, DDR5-4800 高达 16GB
- 丰富I/O: 4x LAN, 4x USB, 4x UART, 2x CAN-FD, 16位 GPIO, I²C/SMBus
- 2x M.2 扩展: E-Key 2230, B-Key 2280
- 支持 EdgeBMC 进行 OOB(带外)远程控制

MIOe 扩展模块

基于MIOe的标准扩展板, 可扩展多种类型的接口和功能, 适用于MIO 2.5" 及3.5" 主板。



MIOe-120

- 2 GbE, HDMI, Mini PCIe
- SIM 卡槽, 扬声器
- LPC, 2 USB 2.0



MIOe-260

- M.2 B-key, Mini PCIe,
- 2 Intel LAN, 2 CAN Bus
- 4 USB2.0, 8 COM

COM 模块化电脑

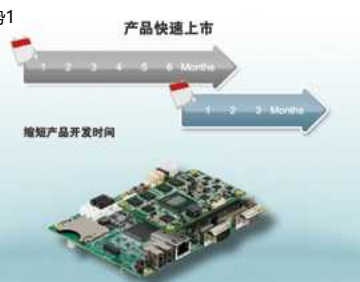
模块化电脑 (COM) 是一种将 CPU、芯片组、内存和外围设备设计在一个部件模块的高集成性板卡。COM 载板必须通电，并带可使用的扩展接口。由于 COM 类型多样化，布线灵活，并支持不同的架构标准，OEM 客户可灵活选择适合其应用的解决方案，节省开发时间。COM 标准包括包括 COM-HPC、COM Express (Basic、Compact、Mini)、Qseven 及 SMARC，支持 PCI Express、SATA、USB3.2、USB、TBT4 等广泛接口。COM 兼容各种电气和机械标准，更换或升级时非常便捷，无需考虑机械和散热问题。因此，COM 成为最受欢迎的应用解决方案设计选择之一。

COM 的优势

优势1

产品快速上市

缩短产品开发时间



优势3

满足弹性需求

- 模块化的散热方案
- COM 模块
- 智能设计功能



优势2

节约开发成本

缩短开发周期及减少设计工作量

客户更专注于其应用的专有技术



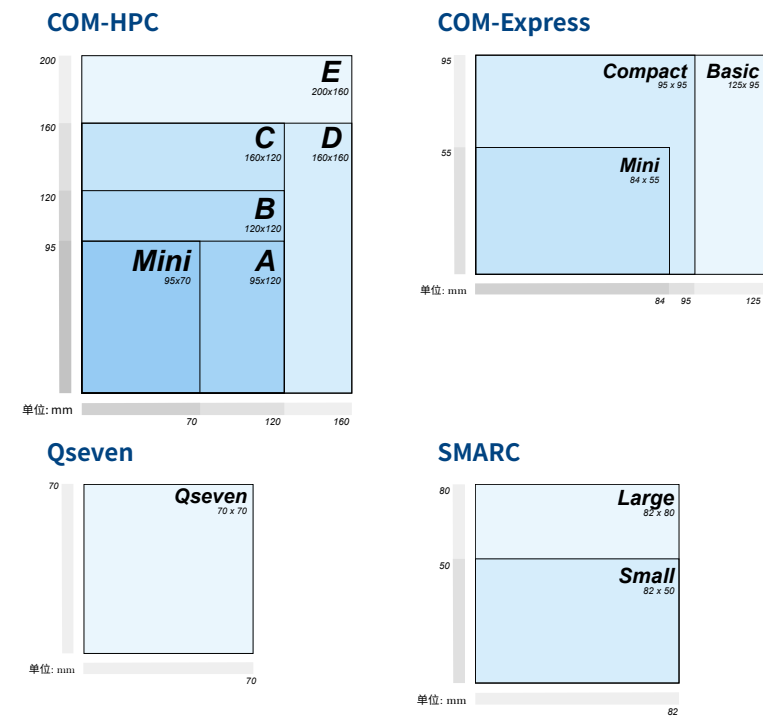
优势4

保护核心技术

可更有效地保护客户核心技术



COM 主要规格介绍



COM设计协助服务

研华COM设计协助服务涵盖客户项目的整个周期，流程包含六个阶段，依次为计划、设计、验证、软件和硬件整合、生产以及供货周期支持。此服务缩短了复杂的应用开发过程，有助于客户专注于自有核心业务。对于客户核心设计，研华的研发部门提供保密协作设计和生产。我们会作为客户的专属工程师以及私人顾问角色，提供设计、验证、生产在内的一站式服务，通过我们的专业团队，客户可方便地选择COM模块、周边模组和软件。研华将复杂的COM开发简单化，使客户能够更好地面对新的市场挑战。



COM-HPC

COM-HPC 是下一代模块化电脑,支持更强大的计算单元,内存容量高达512GB,同时提供下一代更高速接口,例如PCIe Gen4/5 (16/32Gbps)、USB4.0 (40Gbps) 和 25G 以太网,可满足不断增长的数据处理和传输需求。COM-HPC 桌面级引脚类型有A/B/C 三种,COM-HPC 服务器级引脚类型有D/E 两种。



NEW

SOM-M250

- Panther Lake-H 16核25W处理器
- COM-HPC MINI 模块
- 板载LPDDR5内存高达64GB,板载NVMe SSD高达1TB
- 符合AS9100航空质量标准



SOM-A350

- Intel Meteor Lake-U/H 处理器
- COM-HPC Client size A 模块
- 双通道DDR5 内存, 高达96GB
- 支持PCIe Gen5, 最多达 8 路 PCIe Gen5, 20路PCIe Gen4



HOT

SOM-C350/B/R

- 16C/65W Intel Alder Lake-S/Raptor Lake-S 桌面插座型CPU
- COM-HPC Client C尺寸模块
- 双通道DDR5 SODIMM, 最大128GB(ECC可选)
- 16 PCIe Gen5, 16 PCIe Gen4, 12 PCIe Gen3



SOM-D580/R

- 20C/118W Intel Xeon D-2700处理器
- COM-HPC Server D尺寸模块
- 四通道DDR4-3200 RDIMM/LRDIMM, 最大512GB(ECC可选)
- 32 PCIe Gen 4, 17 PCIe Gen 3, 4 25GBASE-KR, IPMB



HOT

SOM-E781

- AMD EYPC 8004 服务器级CPU, 高达 64C/200W
- COM-HPC 服务器级 Size E 模块
- 带 6 个DDR5 RDIMM, 最高支持576GB 内存
- 79路PCIe Gen5, 包括48 路CXL1.1

COM Express Basic

COM-Express Basic 外型尺寸为125mmx95mm, 目前研华最新产品可以支持Intel Core i ultra 3处理器平台。扩展丰富, 特别适用于要求高计算能力的应用。



NEW

SOM-5994

- Intel Atom P6900处理器, 16~24核, 最大 TDP 86W
- COM Express R3.1 Basic Type 7 引脚定义
- 双通道 DDR5-4800MT/s, 最高支持 64GB SODIMM 内存
- 高速以太网接口: 4 x 10GBASE-KR、1 x 2.5GbE



SOM-5993

- 10C/67W Intel Xeon D-1700 处理器
- COM Express R3.0 Basic Type 7模块
- 高速以太网(4 10GBASE-KR, 1 GbE)
- 丰富扩展: PCIe x16 Gen4, PCIe Gen4 x 8 2 PCIe Gen3 x4, 4 USB3.0, 2 SATA3



NEW

SOM-5886

- 第十六代Intel Panther Lake-H处理器, 集成NPU, 总算力高达180 TOPS
- 双通道 DDR5-6400MT/s 高达128GB
- SODIMM
- 丰富扩展接口: 2.5GbE, 20 x PCIe Gen4, 多路USB4 & USB3.2, 4个独立 4K显示



HOT

SOM-5885

- 第十四代 Intel Meteor Lake U/H处理器
- COM Express R3.1 Basic Type 6模块
- Intel Xe LPG 显卡, 最高达128EU, 支持4个4K独显
- 超高速I/O: 最多32路 PCIe Gen4, USB4, USB3.2, 2.5GbE



SOM-5883

- 第十一代 Intel Xeon/Core 处理器
- COM Express R3.0 Basic Type 6 模块
- Intel Iris Xe(Gen 12)显卡, 4个独立4K 显示屏
- 超高速I/O: PCIe Gen4 x 16, USB3.2 Gen2, 2.5GbE

COM Express Compact

研华COM-Express Compact 是其中一款 COM-Micro 精简型系列产品, 该系列产品皆采用低功耗处理器设计。与 COM-Express Compact Type 2 标准款一样, 具有相同的功能和针脚定义, 然而机板尺寸较小, 只有 95 x 95 mm, 是低功耗行动应用非常好的解决方案



SOM-6884

- 第十三代 Intel Core 处理器
- COM Express R3.1 Compact Type 6
- 双通道内存, 高达64GB, 4800MT/s
- 独立四显: 3DDI, LVDS/eDP
- 高速 I/O: 16 PCIe Gen4, 8 PCIe Gen3, 2 USB4 & 4 USB3.2 Gen2



NEW

SOM-6886

- 第十六代 Intel Panther Lake-H 处理器, 集成 NPU, 总算力高达 180 TOPS
- 支持双通道 DDR5 高达 128GB 或板载 LPDDR5 64GB
- 丰富扩展接口: 2.5GbE, 20 x PCIe Gen4, 多路 USB4 & USB3.2, MIPI



NEW

SOM-6874

- COM Express R3.1 紧凑型模块, Type 6 引脚定义
- 搭载 AMD Ryzen AI 嵌入式 P100 处理器, 高性能 Zen 5C/Zen5c 架构 CPU, 高达 12 核 / 24 线程
- 集成 AMD Radeon RDNA 3.5 显卡, 支持 4 路独立 4K 显示输出
- 集成 AMD XDNA 2 NPU, AI 算力高达 50 TOPS



SOM-6873

- AMD Ryzen 嵌入式 4nm SoC-8000 APU
- COM Express R3.1 Compact 模块 Type 6
- 双通道 DDR4 SODIMM, 高达 96GB
- 独立 4 显示 (DP++, HDMI, VGA, eDP)



SOM-6833R

- 第十一代 Intel Core/Celeron 处理器
- COM Express R3.0 Compact Type 6
- 高达 32GB 板载双通道 DDR4
- 独立四显: 3 x DDI, eDP/LVDS 或 VGA
- 丰富 I/O: 1 PCIe x 4 Gen4, 1 USB4 Type-C

COM Express Mini

研华 COM-Express Mini 系列机板尺寸只有 84 x 55 mm, 该系列兼容于 COM Express Type 1 的标准针脚定义, 经小幅修改后, 能够和现有的 COM-Express 或 COM-Micro 载板共享, 是非常适合个人手持式应用的解决方案。



SOM-7583

- 第十一代 Intel Core 处理器
- COM Express R3.0 Mini Type 10 模块
- 支持高达 16GB LPDDR4 板载存储
- 高速 I/O 接口: USB4 Type-C
- 板载 NVMe SSD 64GB (最大 128G)



SOM-7533

- Intel Core-i/Pentium/Celeron 和 Atom x7000 系列处理器 (Alder Lake-N)
- COM Express R2.1.1 Type 10
- 单通道内存 LDDR 4800MT/s, 支持 IBEC
- 板载存储最高 64GB eMMC
- 支持双显: LVDS/eDP (可选) / HSDMI / Displayport

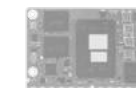
SMARC

SMARC 是一种用金手指连接载板的小尺寸核心模块。其功耗低, 且支持宽压输入, 目前有两种尺寸 (82x50mm/82x80mm), 此外还支持板载内存和存储。研华 SMARC 可支持 2 个网口且集成了 WiFi 功能。



SOM-2533/R/T

- Intel Core-i/Pentium/Celeron 和 Atom x7000 处理器
- 独立三显, 支持 4K/2K (DP++, HDMI, LVDS/eDP/MIPI-DSI)
- 单通道 LPDDR5 4800MT/s 高达 16GB, 支持 IBEC, 板载 eMMC
- 支持 PCIe Gen3, USB3.2 Gen2, SATA, CAN-bus, 双网口支持 TSN



NEW

SOM-2534

- 最新 Intel Wildcat Lake-U 处理器, 支持最高 6 核, TDP 12-28W, 32EU 核显
- 板载 LPDDR5x 内存, 最高 16GB; 板载 UFS3.1 闪存, 最高 256GB
- 集成 NPU, SoC AI 算力高达 40 TOPS
- 丰富扩展: 4 x PCIe 4.0, 2 x USB3.0, 2 x 2.5G LAN

Qseven

Qseven 概念体现于一种即用型、多厂商的模块化电脑, 它整合了普通 PC 的核心部件。研华 Qseven 模块采用标准 70mm x 70mm 尺寸规格, 且具有优化排针配置。



SOM-3569

- Intel Pentium 和 Celeron N4200 系列 SoC
- Qseven 2.1 规格
- 板载 LPDDR4 高达 16GB, 板载 eMMC 高达 64GB
- 支持 HEVC/H.265、H.264 MPEG2 硬件解码
- GbE, 3 PCIe x1, 2 USB3.0, 5 USB2.0

RISC/Arm 运算平台解决方案

研华Arm-Based解决方案提供多种尺寸核心板、工业主板、工控机、网关，搭载NXP/瑞芯微/TI/高通/英伟达/联发科等处理器。除硬件产品外还提供Linux/Android/Windows（部分）等操作系统，BSP及丰富的API支持服务，协助客户产品快速上市并确保长期稳定可靠。



即时上市
硬件解决方案

- 标准的规格
- 灵活的I/O设计
- 设计协助服务



统一的软硬件
及BSP服务

- 快速跨平台开发
- 即插即用外设
- 优化系统资源管理

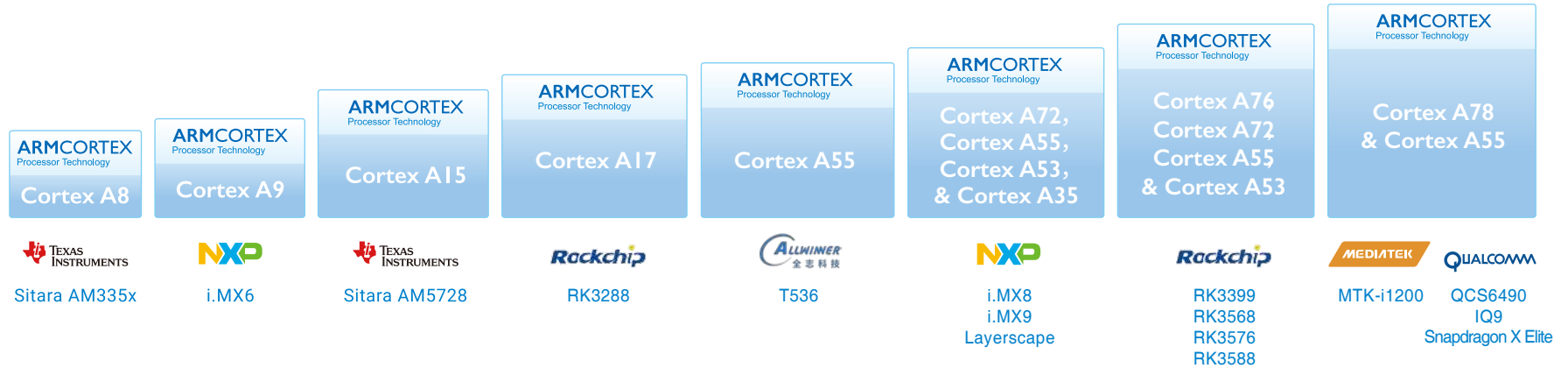


垂直行业拓展

- 长期合作伙伴关系
- 本地及时支持
- 垂直产业的软硬件服务

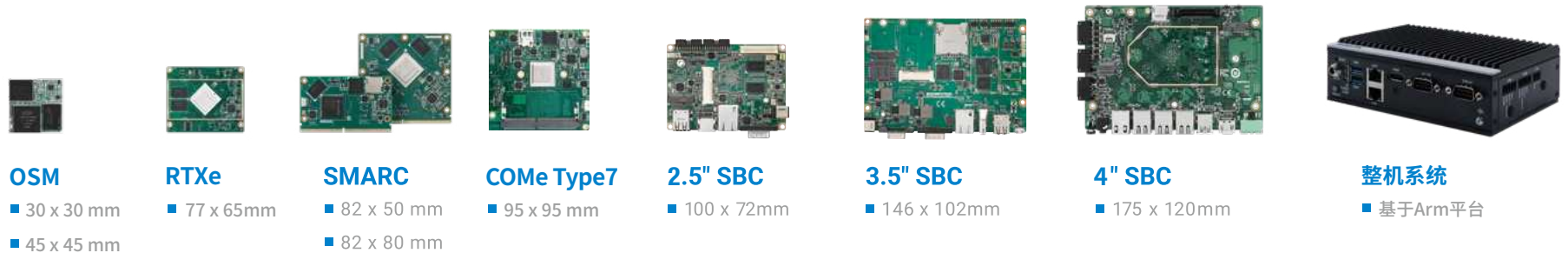
最新SoC平台

研华采用不同Arm处理器平台来满足不同行业应用需求, 包括符合工业应用特性的NXP, 适用于物联网、多媒体应用的Rockchip, 在AI边缘计算应用广泛的NVIDIA等。



丰富产品规格

研华拥有丰富产品形态的标准品, 便于客户快速选择和开发, 包括OSM、SMARC、RTXe、Qseven等标准的核心模块, 2.5"、3.5"、4"的嵌入式单板, 以及适用于工业物联网、边缘计算的网关和嵌入式工控机。



NXP 系列

i.MX 8M Plus 系列



ROM-5722 SMARC 2.1 核心模块

- 1 x HDMI, 1 x 双通道LVDS或1 x 4 lane MIPI-DSI, 1 x 单通道LVDS
- 2 x USB3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, 1 x USB 2.0 OTG, 4 x UART, 5 x I2C, 14 x GPIO, 1 x PCIe3.0, 2 x GbE, 2 x CAN



RSB-3720 2.5" 单板电脑

- 1 x HDMI, 1 x 单/双通道LVDS或1 x MIPI-DSI
- 1 x RS232/422/485, 1 x USB3.2 Gen1, 1 x USB2.0, 1 x Micro SD



EPC-R5710 边缘智能系统

- 5路千兆网口,路由,1路千兆光口
- USB3.0,USB2.0,RS232,RS485, CAN FD,SATA,SD
- 扩展AI加速卡,5G,4G,GPS, Wi-Fi 5, Wi-Fi6, BT

i.MX 8 ULP系列



ROM-2620 OSM 核心模块

- 1 x 4 lane MIPI-DSI
- 1 x USB2.0, 1 x USB 2.0 OTG, 5 x UART, 2 x I2C, 24 x GPIO, 6 x PWM, 1 x CAN



ROM-2820 OSM 核心模块

- 1 x 4 lane MIPI-DSI, 1 x 单通道LVDS
- 2 x USB 2.0, 5 x UART, 4 x I2C, 16 x GPIO, 2 x PWM, 2 x CAN-FD

NXP 系列

i.MX 95 系列



AOM-2521 OSM核心模块

- 1 x 4 lane MIPI-DSI, 1 x 单/双通道LVDS
- 1 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 5 x UART, 5 x I2C, 7 x GPIO, 3 x PWM, 2 x CAN-FD



AOM-5521 SMARC 核心模块

- 1 x 双通道LVDS, 1 x 4 lane MIPI-DSI (可选), 1 x HDMI (可选)
- 1 x USB3.2 Gen1B, 4 x USB2.0, 1 x USB 2.0 OTG, 4 x UART, 5 x I2C, 14 x GPIO, 2 x PCIe3.0, 2 x CAN-FD



AOM-2721 OSM 核心模块

- 1 x DP, 1 x 4 lane MIPI-DSI, 1 x eDP1.4
- 1 x USB3.2 Gen1, 1 x USB2.0, 3 x PCIe Gen3.0, 2 x I2S, 5 x UART, 3 x SPI, 39 x GPIO, 4 x I2C, 2 x 4 lane MIPI-CSI



AOM-6731 SMARC 核心模块

- 1x DP, 1x eDP
- 2 x USB3.2 Gen2, 4 x USB2.0, 3 x PCIe Gen3.0, 5 x UART, 1 x SPI, 5 x GPIO, 2 x I2C, 4x MIPI-CSI



RSB-3810 2.5" 单板电脑

- HDMI 4K60帧, 1 x 双通道LVDS
- 1 x M.2 3052 Key B for 5G, 1 x M.2 2230 Key E for WiFi/BT
- 支持 Ubuntu, Ycoto Linux, Android

Qualcomm 系列

QCS6490 系列

Snapdragon X Elite 系列

Mediatek系列

Mediatek Genio 1200系列

Rockchip 系列

RK3568 系列



ROM-5880 SMARC 核心模块

- 1 x HDMI 2.0, 1 x LVDS/MIPI DSI/eDP
- 4K H.264/H.265视频解码



RSB-4810 3.5" 单板电脑

- 1 x HDMI 2.0, 1 x LVDS /MIPI-DSI 和1 x eDP
- 4K H.264/H.265视频解码, 支持独立三显



AFE-E630 储能网关

- 2 x RJ45, 2 x USB3.0, 1 x HDMI
- 2 x RS232/R485, 1 x CAN FD, 6 GPIO
- 4G/GPS/Wi-Fi/BT/NVME/ SD

RK3576 系列



AOM-3841 RTXe 核心模块

- HDMI, DP, 1 x 4 lane MIPI-DSI
- 2 x GMAC, Type C, 1 x PCIe 2.1/SATA 3.1, 1 x PCIe 2.1/SATA 3.1/USB 3.2 Gen1, SDIO, 3 x MIPI-CSI, 3 x UART



AOM-5841 SMARC 核心模块

- HDMI, DP, 1 x 4 lane MIPI-DSI
- 1 x PCIe 2.1, 1 x USB3.2 Gen1, 1 x USB 2.0 OTG, 3 x UART, 2 x GbE, 2 x CAN-FD, SDIO, 2 x MIPI-CSI

Rockchip 系列

RK3588 系列



AOM-3821 RTXe 核心模块

- HDMI, DP, eDP, HDMI IN
- 1 x PCIe 3.0 x4, 2 x GMAC, Type C, 2 x USB 3.0 signal, 3 x USB 2.0, 2 x PCIe 2.1/SATA 3.0, SDIO, 2 x MIPI-CSI, 2 x UART



ROM-6881 SMARC 核心模块

- HDMI, DP, eDP, 双通道LVDS/DSI
- 8K视频编解码, 支持独立四显
- 4 x PCIe 3.0, 2 x GbE, 2 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB2.0, USB2.0 OTG, SATA 3.0, 4 x MIPI-CSI, 4 x UART, 12 x GPIO, 5 x I2C



ASR-A501 4" 单板电脑

- 3 x GbE & 1 x 2.5GbE, 1xHDMI, 2 x USB3.0, 2 x CAN FD, 2 x RS-232/485, 2 x RS-485
- 支持扩展MIPI, 6xGMSL or 6xAHD
- 可扩展M.2 2230 E key, M.2 3052 B key



AFE-R761 机器视觉系统

- 支持接入6 x GMSL/AHD Camera
- 1 x M.2 M-key, 1 x M.2 B-key, 1 x M.2 E-key
- WIFI6, 5G, Hailo-8, Deepx NVME, mSATA
- 支持接触8KV, 空气 15KV ESD 保护



AFE-E620 边缘智能系统

- 全志T536 Arm 4 x Cortex-A55, 高达1.6 GHz
- 集成单核 E907 RISC-V 处理器, 最高频率可达 600MHz
- 集成NPU高达2 TOPs
- 内置1GB DDR3L内存(双通道)
- 16GB和64GB eMMC 可选

全志系列

EPC 嵌入式工控机

研华嵌入式工控机涵盖面向3.5” 单板电脑和Mini-ITX主板的系列机箱和系统。所有产品均采用优化型机械设计和灵活的I/O接口选择，能够在保证设计效率的同时为客户提供很大的灵活度。丰富多样的标准型号，采用完全兼容的板卡和机箱产品，协助用户快速将其集成至自有应用，缩短设计周期，有效降低投入成本。

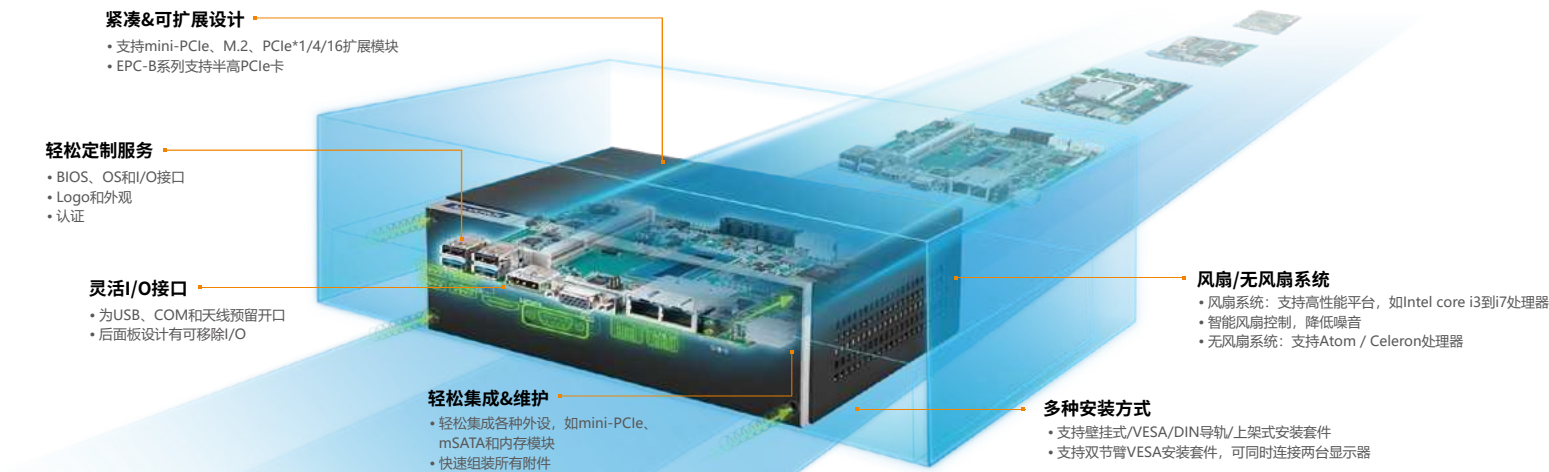
P 系列: 专用型工控机，可执行多重运算任务，适于AI、服务器、视频监控、机器视觉检测、机器人控制等场景。

B 系列: 基础型工控机，工业级坚固设计、扩展性强，通用多重工业应用场景。

S 系列: 超小尺寸设计，超低功耗，性能均衡，适用于机器人控制器，室外5G 基站，安防监控等应用。

T 系列: 1U 薄型工控机，兼顾薄型和PCIe 扩展，注重精简化薄型应用，如KIOSK 自助设备，支持AI 相关领域。

R 系列: 采用RISC/ARM 架构嵌入式工控机，基于恩智浦、瑞芯微、海思、TI、高通等多平台



一站式解决方案 助您快速配置&轻松组装



选择模块

- 处理器
- 扩展插槽
- 功能I/O
- 散热
- 生命周期



选择外设

- Wi-Fi、4G/LTC
- 存储模块
- 转接卡



选择软件系统

- DeviceOn
- 嵌入式操作系统
- 嵌入式 BIOS



配送出货

- 系统组装
- 功能测试、烧机测试
- 全球支付

S系列



EPC-S201

支持 Intel Atom 第六代 N3350 双核掌上型无风扇超薄嵌入式工控机

- 支持 Intel Atom N3350 双核 SoC
- 工业级超薄系统, DIN 导轨/壁挂式安装
- 前面板带 VGA, COM, 2 x USB3.0, 1 x LAN
- 侧面板带 1 DIO, 1 COM
- 支持研华 WISE-PaaS/RMM



EPC-S202

搭载 Intel Atom E3900 系列嵌入式无风扇超薄系统整机

- 板载 4GB DDR4, 32GB eMMC
- DIN 导轨或壁挂式设计
- HDMI 显示@4K
- 灵活扩展: M.2 E key, mSATA/mPCIe

B系列



EPC-B2208

支持 Intel 第 12/13/14 代 Core i 处理器和 H610E 芯片组

- 1 x PCIe 扩展位 (半高)
- 2 x 2.5 寸防震硬盘架
- 2U 高度, 支持上架



EPC-B3508

支持 Intel 第 12/13 代 Core 处理器和 H610E 芯片组

- 3 x PCIe 扩展槽位
- 350W 电源
- 3U 高度, 支持上架



EPC-B3522

支持 AMD Ryzen AM4 5000 系列处理器与 X570 芯片组

- 搭载 NVIDIA RTX-A4500 显卡
- 3 x PCIe 扩展槽位
- 500W 电源

T系列



EPC-T4219

板载 Intel 第 12 代 Core iN 系列 i3-N305/N97

- 12V DC-IN 供电, 锁定式直流电源插孔
- 无风扇散热设计
- 188 x 188 x 44mm, 1U 薄型设计



EPC-T428A

支持 Intel 第 12/13/14 代 Core i 处理器和 H610E 芯片组

- 12V DC-IN 供电, 锁定式直流电源插孔
- 1 x 2.5 寸抗震硬盘托架
- 44mm 超薄设计, 支持上架



EPC-T5294

板载 Armv9 架构 Neoverse V3AE 系列处理器, 小尺寸超薄嵌入式工控机

- 搭载 NVIDIA Jetson T4000/T5000 模组, 最高可达 2560 Core
- 独立双显: DP/HDMI, 高达 4K 分辨率
- 24V DC-IN 供电, 4pin 凤凰端子

R系列



EPC-R3710

搭载瑞芯微 RK3399 嵌入式工控机支持 UIO40-Express 扩展

- HDMI 1920x1080 @ 60Hz
- 双 Lan 口, 1 x 2-wire RS-232, 1 x USB3.0, 1 x USB2.0, 1 x Micro SD
- 1 mini-PCIe 支持 LTE/WiFi/BT 模块



EPC-R3720

搭载 NXP i.MX8M Plus 嵌入式工控机

- 搭载 NXP i.MX8M Plus 嵌入式工控机
- HDMI 高达 3840 x 2160, 分辨率为 30Hz
- 2 x 千兆网口, 1 x USB 2.0 & 1 x USB 3.2
- 1 个 Micro SD 插座和 1 个 Nano SIM 卡插槽
- 1 个适配 4G 的 mini-PCIe 插槽, 1 个 M.2 2230 E Key 插槽

ARK 无风扇工控机

研华ARK系列工控机是工业应用的理想选择,如储能管理、自助服务机、工厂自动化、机器人、机器视觉等智能化应用。ARK平台具备稳定性、可扩展性和安全性的设计,提供AI附加计算能力,丰富的I/O接口,支持各类协议以及全球认证。ARK系列根据垂直市场不同需求,设有多系列、多尺寸、多性能产品,加速企业智能边缘转型。



系统集成与量产固化

支持系统镜像、容器部署、OTA
升级回退及系统诊断能力



AI 软件平台

快速部署,软件集成、模型优化,
帮助客户快速部署

DeviceOn EdgeAI SDK CODESYS aconitis intel GETi



丰富的I/O扩展

支持多功能的IO应用与
扩展

TSN CANbus PCIe® 4.0



无线连接

支持 5G/LTE、WiFi 6E 模块,
提供设计咨询服务



在 30 多个国家获得全球 (范围) 认证



导轨型系列



ARK-1222

- Intel N97 和 x7433RE 四核 SoC
- DIN 导轨系统, 前面板边框配备基本 I/O 端口
- 双独立 4K HDMI 接口
- 2 个 Intel i226-IT 接口和 4 个 RS-232/422/485 接口
- 2 个 USB 3.2 接口和 2 个 USB 2.0 接口



ARK-1251

- Intel Core Ultra 5/Ultra 7 处理器
- DDR5-5600 SO-DIMM 内存支持最高 96G
- 高达 3 x Intel GbE, 4 x serial ports, 8-bit DIO, 可选配 CANBus
- 电源输入 12V ~ 28V
- 支持宽温运行 -20 ~ 60 °C

紧凑型系列



ARK-1125

- Intel Atom Processor x7211E 双核 SoC
- DDR5-4800 SO-DIMM 内置支持最高 16G
- 四个串行端口
- M.2 E Key, B Key 和 M Key 用于存储和无线模块安装
- 支持宽温运行 -30 ~ 60 °C



ARK-2252

- Intel Core Ultra 3 系列 Panther Lake 处理器
- 支持 DDR5-6400/7200 CSODIMM 内存, 最大容量 128G
- 最高支持 4 x Intel GbE、6 x 串行端口、8-bit DIO、2 x CANBus、4 x USB 3.2、2 x USB 2.0
- 扩展工作温度范围: -20 ~ 60 °C
- 12V~24V 宽电压输入

高性能系列



ARK-3532

- Intel 10 th Gen. Xeon W and Core i3/i5/i7/i9 处理器
- 支持独立三显: VGA + HDMI + 可选显示模块
- DDR4 SO-DIMM ECC/non-ECC 最高可达 64 GB
- 9-36VDC 宽电压电流输入
- 支持 4GbE, 8USB, 6COM, 16bit DIO, TPM2.0



ARK-3533

- 支持 Intel 12/13/14 代酷睿 i3/i5/i7/i9 处理器
- 双显示器: HDMI+HDMI
- DDR5 SO-DIMM 内存支持高达 64 GB
- 9-36VDC 宽范围电源输入
- 支持 2 x 2.5 英寸硬盘驱动器托架
- 支持高达 4GbE、8USB、8COM、16 位 DIO、2CANBus、TPM2.0



ARK-3534

- 支持 Intel 酷睿第 12/13/14 代 i3/i5/i7/i9 处理器
- 三重独立显示器: HDMI+HDMI+ 可选显示器
- DDR5 SO-DIMM 内存支持高达 64 GB
- 9-36VDC 宽范围电源输入
- 支持高达 4GbE、8USB、8COM、16 位 DIO、2CANBus、TPM2.0



ARK-3535

- 支持 AMD Ryzen 8640U/8845HS 处理器
- 支持 DDR5-5600 SO-DIMM 内存, 最大容量 96G
- 三屏输出: 2 个 4K HDMI 接口 + 1 个 4K Type-C(Alt 模式) 接口
- 最高支持 4 个 Intel GbE 端口、6 个 COM 端口、8 个 USB 端口、16 位 DIO 及 2 个 CANBus

DS 数字标牌解决方案

研华的数字标牌播放器专为加速智慧城市及商业环境数字化转型而设计。该系列产品搭载高性能计算平台，支持多屏显示与AI增强互动功能，可实现实时内容推送并创造沉浸式用户体验。我们的解决方案采用超薄无风扇设计，配备模块化SDM架构以实现灵活集成，并通过工业级耐久性认证确保7×24小时稳定运行。



intel Windows Ubuntu



chromeOS Trellix Acronis



尺寸小巧 & 安装简便



出色性能 & 流畅播放



认证级数字标牌
内容管理系统

数字标牌专用系统



DS-011

- 由高通骁龙 8 核 QCS6490 2.1GHz 提供动力支持
- Hexagon™ 770 AI 引擎，高达 12 万亿次操作每秒 (TOPS)
- 适用于高达 19200 万像素摄像头的三重网络接入方案
- 高通应用开发人工智能中心



DS-015

- 搭载 NVIDIA 6 核和 8 核 Arm Cortex-A78AE v8.2 64 位处理器
- 多种 AI 工作负载最高可达 157 TOPS (INT8)
- 超薄设计，配备智能风扇散热
- 连接接口：3 个 USB 3.2 Gen 1 端口，1 个 USB Type-C 端口



DS-084

- AMD R2000 系列 CPU 和 AMD Radeon GPU 提供动力
- 支持电视墙的 HDMI 2.1 TMDS 端口
- 双通道 DDR4 内存架构实现稳定播放
- 双千兆网口支持互联网 / 局域网 / 流媒体传输

数字标牌专用系统



DS-330

- Intel® Atom™ x7433RE, Processor N97, i3 N305
- 无风扇坚固设计：适用于半工业与户外环境，支持 -20° C 至 60° C 的宽温运行
- 三路 4K 显示支持：配备 2 个 HDMI 和 1 个 USB-C 输出，呈现惊艳的超高清视觉效果
- 体积小巧：仅 180 x 150 x 35 mm，非常适合部署于自助终端、零售和智慧城市场景



DS-380

- 搭载 Intel Core Ultra 5 125H/135H 处理器
- 双通道 DDR5 SODIMM 内存，最高支持 48GB
- 4×HDMI 显示输出，最高支持 4K 分辨率 (3840×2160)，HDMI 1 接口支持 8K
- 丰富 I/O 接口：2× 网口、4×USB、1×COM、1× 红外接口
- NPU 算力达 11 TOPS，支持 AI 框架



DS-410

- 采用 Intel Atom J6412 处理器，时尚铝制压铸设计
- 通过板载 4GB/8GB DDR4 (3777Mhz) 优化 GFX 性能
- 支持 HDMI 2.0 高达 4K(3840 x 2160)，以及 VGA 全高清
- 双 USB 3.0、双 Gb LAN、通过 RJ11 端口的双 RS232
- DeviceOn 智能屏幕警报和监控

AIR 边缘 AI 推理系统 & 服务器

研华边缘 AI 解决方案可提供具备可扩展性、高安全性且面向行业场景的人工智能计算能力，覆盖推理至二次训练全流程。平台融合视觉 AI 与生成式 AI 技术，并配套集成化软件工具包，实现即插即用，可在边缘端完成实时数据分析、智能决策支持，同时保障数据安全。



高扩展边缘 AI 计算

全系列产品支持
CPU、NPU、GPU 多维加速

配套软件工具包

整合核心 AI 软件工具，
提供即插即用的一站式解决方案

深耕垂直行业

依托 AI 加速能力与外设无缝集成，
大幅提升开发效率

边缘AI加速卡



EAI-1200

- Hailo-8 芯片算力可达 26TOPS
- 采用 M.2 紧凑型工业标准规格
- -20~60°C宽温环境稳定工作
- 低功耗控制至 2.5W
- AI 套件支撑模型推理开发



EAI-2100/EAI-3100

- 搭载 A370M 显卡, 内置 8 组 Xe 运算核心
- 采用 MXM 规格, 兼容 PCIe x16 总线
- 主频 1550MHz, 配 4GB 64 位 GDDR6 显存
- 0~60°C稳定运行, 保障长久供货周期
- 根据 GPU 温度自动进行智能风扇控制

边缘AI推理系统



AIR-055

- 紧凑型高性能边缘 AI 盒子算力可达 100 TOPS
- 搭载高通 IQ9075M 核心处理器
- 12~24V 宽压及 -20~60°C宽温运行
- 多网口串口, 多路高速 I/O 端口齐全
- 双路 USB Type-C, 多路 MIPI 影像接口
- 三路 M.2 插槽, 支持固态与 5G 扩展



AIR-075

- 搭载最新 Jetson Thor T5000 计算模块
- 可提供高达 2070 TFLOPS(FP4) 的 AI 性能
- 支持 4x 10GbE, 配备 Base-T 接口
- 支持 4x MIPI-C 接口, 兼容 MIPI-C 与 GMSL 接口
- 丰富的 I/O 扩展: 2 x USB-C、2 USB-A、3 x M.2
- 可支持 19~36V 宽压及 -15~60°C 宽温工作环境

边缘 AI加速卡及系统



AIR-120

- 搭载 Intel CPU, 最大 16GB DDR5 内存
- 兼容 M.2 与 2.5 英寸固态硬盘存储
- 双显双网口配备丰富工业 I/O 接口
- 支持端口拓展包含 CANFD 与 DIO 外设
- -20~60°C宽温并可选 26TOPS 算力模块



AIR-310

- Intel 14th Corel 处理器
- 最大拓展 64GB 大容量 DDR5 内存
- HDMI+DP 双显示输出画面更丰富
- 可搭载 60W MXM3.1 高性能显卡
- 已通过 Edge AI SDK 认证



AIR-410

- Ryzen 8040 处理器算力可达 39TOPS
- 双通道 DDR5 内存最大扩容至 96GB
- PCIe x16 插槽搭载 550W 独立显卡
- 标配 850W 电源保障整机稳定运行
- 搭载 AI 工具包兼容双主流操作系统



AIR-420

- 28.6L 紧凑机箱, 双宽显卡扩展插槽
- AMD RYZEN 7000/9000 多核高性能处理器
- 四路 PCIe 插槽, 兼顾显卡与外设拓展
- 智能温控风扇搭配冗余工业电源
- 配套 AI 软件, 简化大模型训练部署

工业 AI 摄像头解决方案

工业 AI 摄像头应用广泛且快速拓展,对成像技术与智能处理能力提出多元需求。集先进光学、AI 算法与边缘计算于一体的工业 AI 摄像头,可实现实时图像识别、分析与决策,广泛应用于制造、物流、机器人及智慧城市等领域。



完整解决方案

根据实际场景灵活配置,
优化成像品质

参数预载

积累并保存参数配置,
新场景快速调用、精细调优

软件集成

统一软件接口,支持初期
评估测试与图像应用开发

系统验证

缩短评估周期,
加速产品迭代开发

CAM-5000 系列



CAM-5530-U

立体视觉摄像头

- USB3 接口
- Depth: 1M(1280x800) / 30fps
- RGB: 1M(1280x800) / 30fps
- Depth: 94° (H) x 62° (V) $\pm 3^\circ$ @ 2m (全局快门)
- RGB: 94° (H) x 68° (V) $\pm 3^\circ$ (全局快门)
- 尺寸: 124 x 29 x 27.7mm



CAM-5530-G

CAM5530 GMSL2 立体视觉摄像头

- GMSL2
- Depth: 1M(1280x800) / 30fps
- RGB: 1M(1280x800) / 60fps
- Depth: 90° (H) x 65° (V) $\pm 3^\circ$ @ 2m (全局快门)
- RGB: 94° (H) x 68° (V) $\pm 3^\circ$ (全局快门)
- 尺寸: 124 x 29 x 36mm



CAM-5330-U

CAM5330 USB 3.0 立体视觉摄像头

- USB3 接口
- 深度模式: 1M(1280x800) / 30fps
- RGB 模式: 2M(1920x1080) / 30fps
- Depth: 90° (H) x 65° (V) $\pm 3^\circ$ @ 2m (全局快门)
- RGB: 86° (H) x 55° (V) $\pm 3^\circ$ (滚动快门)
- 尺寸: 90 x 25 x 30.7mm

CAM-2000 系列



CAM-2210-U

CAM-2210 USB3 工业摄像头

- 索尼 IMX335 传感器, 搭载 ISP5 图像处理器
- USB3 接口
- 5MP(2560x1920) / 30fps
- M12 / F1.6 / 130.7° (D) x 100° (H) x 73.4° (V), 支持滚动快门
- 尺寸: 51.2 x 39.5 x 29mm



CAM-2210-G

CAM-2210 GMSL2 工业摄像头

- 索尼 IMX335 传感器, 支持 ISP5(YUV)
- GMSL2 接口
- 5M(2560x1920) / 30fps
- M12 / F1.6 / 130.7° (D) x 100° (H) x 73.4° (V), 滚动快门



CAM-2220-G

CAM-2220 GMSL2 工业摄像头

- ONSEMI AR0234 + ISP5(YUV)
- GMSL2 接口
- 2.3M(1920x1200) / 60fps
- M12 / F1.8 / 113.4° (D) x 95.8° (H) x 59.6° (V), 全局快门
- 尺寸: 29 x 39.5 x 55.7mm



CAM-2320-G

CAM-2320 GMSL2 工业摄像头

- ONSEMI AR0822 + ISP5(YUV)
- GMSL2
- 4K(3840x2160) / 30fps(4lane)
- M12 / F1.8 / 130° (D) x 112° (H) x 62° (V),
- 滚动快门
- 尺寸: 29 x 39.5 x 56.4mm



CAM-2110-G

CAM-2110 GMSL2 工业摄像头

- SONY IMX290 + ISP5(YUV)
- GMSL2
- 2M(1920x1080) / 60fps
- M12 / F1.8 / 106.6° (D) x 92.6° (H) x 51.8° (V),
- 支持滚动快门
- 尺寸: 39.5 x 29 x 52.9mm



CAM-2310-G

CAM-2310 GMSL2 工业摄像头

- 8M4K(3840x2160@30fps) 4 传输通道 GMSL2 工业相机
- SONY IMX415 STARVIS CMOS 传感器
- 卷帘快门
- M12 / F1.8 / 148.4° (D) x 125.4° (H) x 67° (V), 8MP/30fps
- 尺寸: 29 x 39.5 x 54.4 mm

工业存储与内存解决方案

作为先进的工业存储和内存解决方案提供商，研华为工业及行业客户提供全面的工业级SSD和DRAM产品。研华产品均采用原厂高品质IC芯片，并通过内部严格的测试：振动测试，老化测试，以及100%的测试，拥有更高品质，更安全可靠，寿命更长的工业级产品特性，服务更多的工业及专业行业客户，如轨道交通，自动化，智能制造，新能源，医疗，5G通信和航天航空等客户。



全方位数据安全保障

- 硬件安全防护
- 软件安全防护
- 第三方安全软件

Trellix Acronis

可靠稳定性

- 原厂 IC 芯片
- 100% 测试
- 3 年保固

DeviceOn/SQ Manager 智能管理软件

- 寿命预测
- 远程监控
- 在线 PMQ

客制化服务

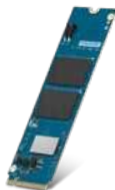
- 涂层保护
- 底部填充
- 数据加密

SQFlash 系列产品



SQF-EU-2

- U.2 SSD, Gen.5x4
- 4X+ 性能增强
- 连续读取：速度达到 14000MB/s
- 连续写入：8200MB/s



SQF-730系列

- M.2 2280, Gen.4 x4
- 0~70°C & -40~85°C
- 连续读取：速度达到 5,000MB/s
- 随机读取：IOPS @4K 700K



SQF-S25 840V/840L

- 支持断电保护功能，保护数据安全
- 抗冲击、抗振动、低功耗
- 支持 AES256 和快速擦除



SQF-930系列

- M.2 2280, w/ 散热片, Gen.4 x4
- w/DRAM, 运行速度更快
- 连续读取：速度达到 7,200MB/s
- 随机读取：IOPS @4K 780K

SQRAM 系列产品



SQR-SD5N/SQR-SD5E

- 工业级 SODIMM DDR5
- 数据传输速率 :5600 MB/s
- 原装 IC 芯片, DRAM
- 支持 ECC 纠错功能
- 内置独立电源管理 IC



SQR-UD5N

- 工业级 UDIMM DDR5
- 数据传输速度：5600MT/s
- 容量：16GB/32GB/64GB
- 原装 IC 芯片, DRAM
- On-Die ECC 功能支持



SQR-RD5N

- 100% 测试
- 支持服务器平台
- 采用原装 DRAM IC 芯片
- 30u" 金手指厚度
- 工作温度：0~85°C



SQR-CX5N

- EDSFF E3.S 2T(2U 短) 规格
- 数据传输速率 :PCIeGen5.0x8 32GT/s
- 工作温度：0°C ~70°C
- 内置独立电源管理 IC
- 支持 ECC 纠错

工业显示解决方案

为满足工业显示屏市场的诸多需求,研华设计、开发并制造了丰富多样的显示器系统,均已广泛部署于全球交通运输、仪器仪表,医疗及多种系统集成市场。通过采用各种先进技术及柔性制造模式,研华能够为客户提供行业先进的定制差异化产品解决方案,从而在市场竞争中占据优势地位。研华始终秉持“以客户为中心”的服务理念,因此产品设计制造过程中的每个环节均紧密围绕客户需求进行,以最终将高品质的产品源源不断地推向市场。



光学性能出色

- 高亮阳光可视
- 低反射光学贴合
- 专业 AG/AR/AS 表面处理

坚固耐用设计

- 前面板 IP65~IP67 防护等级
- 宽温运行: $-30\sim 85^{\circ}\text{C}$
- IK08 抗冲击保护
- 面板支持 7×24 小时不间断运行

沉浸式设计

- C/J 型曲面触控显示器
- 可编程 LED 灯带
- 色彩校准

全程长效支持

- 定制化设计导入方案
- 完整 DTOS 服务
- 最低 3 年供货保障
- 2 年标准质保

标准工业显示器

研华IDS-32系列标准工业显示器,采用6.5"~21.5"超轻、超薄工业级设计。其开放式架构前面板支持灵活定制,易于重新设计,是各种嵌入式应用的理想选择。



IDS-32系列

- 6.5"~21.5" 尺寸选择
- 坚固型金属前框
- 双 VGA/DVI 接口
- 投射电容式触摸 / 电阻式触摸 / 无触摸
- 框架式安装 / VESA 安装

开放式模组

研华IDS-31系列是一款可定制的多尺寸显示解决方案,可根据客户需求定制触摸技术以及高亮度、视频输入等多种用户选择,如DisplayPort。多种紧凑型机械结构选择展现了产品设计的灵活性。



IDS-31系列

- 6.5"~21.5" 尺寸选择
- 开放式支架
- 双 VGA/DVI 接口
- 投射电容式触摸 / 电阻式触摸 / 无触摸
- 嵌入式安装 / VESA 安装

纯平显示器

研华纯平系列专业显示器专门面向具有时尚感需求的应用,例如公共标牌、一线信息、医疗及销售点应用。超薄显示器采用全平面、易清洁、易维护的玻璃表面,有助于延长产品使用寿命。



IDP-31系列

- 7"~27" 尺寸可选
- HDMI/VGA/DVI 接口
- 台式 / 壁挂式安装
- 100% 纯平玻璃前面板
- 十点触控

户外高亮度显示套件

研华IDK-2000系列提供 1200-nit工业级户外高亮度显示器,尺寸介于 8.4"~21.5",高亮度及宽温运作可减少20%能量消耗,是户外显示器的理想选择。



IDK-2000系列

- 8.4"~21.5" 尺寸选择
- 户外应用
- 支持 LVDS 信号接口
- 电阻式和投射电容式触摸
- 广视角

室内工业级显示套件

研华IDK-1000系列工业级显示套件,提供5.7"~21.5"工业级LCD面板, IDK-1000系列坚固耐用的高亮度面板提供宽温及经久耐用支持,满足不同应用需求。



IDK-1000系列

- 5.7"~21.5" 尺寸选择
- 室内应用
- 支持 LVDS 信号接口
- 电阻式和投射电容式触摸屏
- 广视角

客制化设计服务

研华提供DTOS服务,可根据用户的特殊应用需求,量身定制显示屏幕解决方案,可定制屏幕尺寸,形状切割,亮度,宽温支持,单双曲面,贴合灌胶等。研华设计团队始终秉承客户至上理念,快速地将OEM需求转换为经济高效、设计精妙的完整解决方案以适应多样化的应用场景。



工业无线解决方案

研华工业无线解决方案(AIW)是一家先进的无线解决方案提供商,通过无线技术连接边缘设备,为人工智能物联网(AIoT)赋能。AIW 提供多样化的连接模块和天线解决方案,适用于不同的垂直应用领域,并专注于基于 AIW 设计服务的无线系统集成。



新一代技术引领者

- Wi-Fi 7
- 5G Redcap
- 无线 MCU
- LTE Cat. 1bis
- GNSS RTK

工业级品质, 长效供货保障

- 5~10 年产品生命周期
- 支持 -40~85° C 宽温运行

无线系统集成

- 天线设计
- 固件与驱动支持

RF 测试与认证服务

- 全球射频认证
- 无线性能测试



无线通信解决方案



EWM-W179

- RTL8852BE
- WiFi6(2.4GHz+5GHz)+BT5.0 | 2T2R
- M.2 封装, WiFi:PCIe; BT:USB
- 工作温度:0~70°C
- 已适配 Windows、linux 操作系统



AIW-169

- RTL8852CE
- WiFi6(2.4GHz+5GHz)+BT5.2|2T2R
- M.2 封装, WiFi: PCIe BT: USB
- 工作温度: -10~70°C
- 已适配 Windows、linux 操作系统



AIW-170/171

- QCA WCN 6856
- WiFi6E(新增 6GHz 频段)+BT5.2 | 2T2R
- M.2,Mini-PCIe 封装, WiFi:PCIe; BT:USB
- 工作温度:-40~85°C
- 已适配 Windows、linux 操作系统



AIW-173BQ

- 工业级温度范围 (-40~85° C)
- 兼容不同平台 (NXP、Qualcomm、Intel & AMD)
- MLO (多链接操作) 支持
- 多重认证 (FCC/CE/IC/TELEC/NCC/RCM)

无线通信解决方案



AIW-162

- Broadcom AP6275P
- WiFi6(2.4GHz+5GHz)+BT5.0 | 2T2R
- M.2 封装, WiFi:PCIe; BT:UART
- 工作温度:-40~85°C
- 已适配 Windows、linux 操作系统



AIW-167

- IEEE 802.11 ax/ac/b/g/n + 蓝牙 5.3 HS 标准
- M.2 规格、1T1R SDIO 接口
- 工业级工作温度范围 (-40~85° C)
- 兼容 NXP i.MX 平台



AIW-356

- 主芯片组: 高通 SDX62
- 最大 UL 峰值速率为 900Mbps
- 最大 DL 峰值速率 3.2 Gbps NR Sub6 EN-DC
- UL 最大支持 2 MIMO, DL 最大支持 4 MIMO



AIW-500

- 与 AIW 模块解决方案匹配
- 无数量限制
- 设计咨询和测试服务
- 适用于关键环境的防水选项

无线电子纸解决方案

该解决方案可支持智能工厂、智能楼宇、智慧病房和公共数字标牌应用。DeviceOn/ePaper 软件管理系统支持自动更新信息，从而提高效率并减少人为错误。



2.9" NFC无电池电子纸



EPD-210

- 2.9" 黑白电子纸
- 具有 180°视角的阳光可读显示器
- 支持通过 NFC 进行数据传输
- 无电池设计，由阅读器供电



EPD-230/232

- 2.9" 电子纸面板显示屏
- ARM Cortex-M3 核心处理器
- 支持 IEEE 802.15.4/2.4 GHz Wi-Fi
- 带 3 个按钮和 3 个 LED 的丰富 I/O 控制

5.6" 多色电子纸



EPD-332/333

- 5.6" 红色 / 黑色 / 白色 EPD
- ARM Cortex-M3 核心处理器
- 出色的漫游和传输性能
- ZigBee 通讯技术

13.3" 大屏彩色电子纸



EPD-660/662

- 13.3" 红色 / 黑色 / 白色 EPD
- 内置电池支持长达 8 个月
- 支持外加电源供电
- 支持 2.4G, Wi-Fi

2.9" 电子纸显示屏模组



EPD-023B

- 嵌入式电子纸显示模块
- 2.9" 黑白电子纸面板显示屏
- RS-485 有线 数据传输
- 极速数据传输和面板刷新

25.3" 全彩大屏电子纸



EPD-258

- 25.3" , >30K 色 (ACeP) 彩色
- 分辨率 3200 x 1800
- USB-A、微型 USB、RJ45 (局域网)、SD 卡
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G)

31.2" 电子纸



EPM-880

- 常温下 31.2"16 级灰色
- 31.2" 1 位黑白，用于宽范围温度
- 超薄低功耗显示面板
- 带 USB 数据传输接口的 EPD 驱动板

无线电子纸案例集



扫码下载

- 系统架构拓扑图
- 系统流程示意图
- 8 大应用领域介绍

DeviceOn/ePaper



电子纸管理I.APP

- 设备远程管理
- 图像生成器
- 固件 OTA

嵌入式操作系统

在操作系统领域,我们作为微软嵌入式全球授权代理商,提供嵌入式正版授权和现成的嵌入式OS镜像,以及一系列增值服务。随着国产化不断加深,研华与国产操作系统厂商统信和麒麟达成合作,可为客户提供软硬整合的国产方案。



统信国产操作系统	Ubuntu操作系统	Windows操作系统	麒麟国产操作系统
- 统信桌面操作系统 V20/V25 - 统信服务器操作系统 V20/V25 - 统信专用设备/智能终端操作系统 V20/V25	- Ubuntu Pro for Devices - Canonical MicroCloud - Canonical AI Consulting Services	- Windows 10/11 IoT 企业版 LTSC - Windows 11 Pro - Windows on Arm - Windows Server IoT - SQL Server IoT - Office LTSC Embedded	- 银河麒麟桌面操作系统 V10/V11 - 银河麒麟高级服务器操作系统 V10/V11 - 银河麒麟桌面操作系统 (工业版)V10 - 银河麒麟高级服务器操作系统 (工业版)V10

端到云的数据安全与综合防护解决方案

为确保客户设备安全,研华整合了Acronis和Trellix这两款全球出色的安全软件,提供从端到云的全面安全防护及备份恢复解决方案,帮助企业有效阻止外部攻击,实现数据安全。



本地安全

Acronis数据备份与恢复

- Acronis True Image
- Acronis True Image OEM
- Acronis Cyber Backup
- Acronis Snap Deploy

Trellix白名单

- Trellix Application Control
- Trellix Embedded Control
- Trellix Integrity Control

研华客制化设计与制造服务 (DMS)

为垂直行业市场量身定制

研华 DMS 设计制造服务拥有数十年行业积淀,打造从产品概念到批量部署的端到端客制化方案。依托全球多点布局的服务网络与制造实力,面向医疗设备、工业装备、智慧能源、智能驾驶等多行业提供定制服务,符合行业高品质标准,适配各类严苛工况。此外,研华积极部署上下游生态伙伴,搭配属地化技术支持,结合边缘 AI 技术,高效缩短客户项目周期,实现灵活定制与稳定交付。



北美地区

- 战略客户全域深耕管理设计
- 制造服务与本土高端制造服务双引擎规模化布局

欧洲地区

- 深度洞察区域客户需求
- 依托全球制造网络,落地本地化设计

中国台湾(总部)

- 全球协同创新研发中心
- 工业与技术领域专业实力
- 全流程设计协助加速方案交付

日本地区

- 战略客户与渠道伙伴拓展
- 立足本土打造日式精工制造

中国大陆

- 聚焦本土垂直行业市场
- 自研国产平台方案
- 一站式本地化服务

研华客制化设计与制造服务 (DMS)

通过全球化与在地化服务实现风险管理与敏捷服务



深度集成的制造中心



中国台湾

- 高复杂度创新业务
- 全球技术研发中心
- 符合 TAA 标准生产



中国昆山

- 一体化配套服务
- 本土化中国制造
- 高性价比规模化量产



日本

- 高端日式精工制造
- 本地技术运维 + 物流支持
- 地缘抗风险能力强, 合规 TAA 标准

品质管理认证

生产

IPC QML/IPC-A-610B

安全

IECQ QC080000/
ISO45001/ OHAS18001

垂直市场

ISO13485/ TL9000/
IECEX QAR

环保/ESG

SONY GP/AEO/C-TPAT

通用

ISO9001/ 14001/
27001/ 17025

客制化服务聚焦医疗行业

研华医疗设备制造商DMS团队是专为医疗设备客户设计的合作伙伴，我们提供从产品设计到制造和维护的整体产品开发服务，并确保在整个产品生命周期中符合认证要求。聚焦下一代医疗保健应用，研华提供专业定制服务，以加速医疗保健中人工智能的应用，并且通过战略变更管理，确保稳定的生产及生命周期。



端到端集成解决方案

- 深耕单板设计统筹
- 系统集成全系硬件
- 产品完整算力平台



专业的客制化服务支持

- 技术咨询服务
- 垂直行业方案
- 多元算力平台
- 散热仿真分析



医护级品质保障

- ISO 13485 IEC
- 60601U.S. FDA 多
- 项标准认证



15年长供货周期

- 长期物料供货保障
- 平台持续维护服务

客制化服务聚焦国产“芯”

研华国产客制化服务深耕中国市场，响应设备国产客制化需求，凭借高端技术、各种层级的客制化能力、灵活的制造方式，研华与国内知名芯片厂商、OS厂商等建立广泛合作，在工业自动化、轨道交通、医疗、金融等领域深耕多年，为客户提供高品质、快速客制化设计服务。



全栈国产化软硬件布局

- 多样化硬件产品覆盖
- 自研BMC管理模块，提供适配国产平台的软件工具包



专业技术支持

- 5年以上产品生命周期
- 本土设计与制造服务



行业客制化能力

- 支持制造业关键设备国产化替代与智能化升级
- 为政务/交通/电力/网安/医疗等领域提供国产化方案



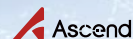
深度生态合作

- 与兆芯/飞腾/海光/鲲鹏等紧密合作
- 深度集成百敖等国产BIOS以及麒麟、统信、鸿蒙等操作系统

Made in China



OpenHarmony



行业专用机



边缘AI计算平台



通用板卡产品



存储/OS及增值软件



Windows

散热方案

安卓系统

处理器

内存

EdgeBMC

工业主板

线缆

Ubuntu

SSD 存储

机箱

电源

DeviceOn

显示

扩展卡

Yocto

网卡

标准 Plus⁺ 客制化订购服务

节省定制时间和成本



标准模型 快速定制选择

- 多样化标准模型供定制选择
- 通过标准产品定制简化开发



专门PM负责 专案管理

- 包括从 RFQ 到大规模生产在内的专用 PM
- 专属单一窗口联系



系统化产品 管理模式

- 产品管理专家
- 系统产品管理



可行&已验证 NPI程序

- 全面 DQA 测试流程
- 可靠性和部件兼容性测试
- EMI 测试符合 ISO&UL 认证规格



可靠地全球 营运服务

- 产品生命周期维保
- 软件维护
- 后勤管理
- 保修服务

工厂所有权

- 后备生产
- 灵活的物流计划
- 完整工厂所有权确保 VIP 待遇

3

生产基地

4

物流中心

多样化生产

- 成熟的定制化系统
- 面向多样化的生产优化
- 降低对接趋势和创新的门槛

4,000

生产 PN/ 月

20 分钟

生产线快速转换

高产能和强执行能力

- 动态材料准备
- 订单交付快速
- 人力及设备充足，可应付大量订单

77.2 万

工业主板产量 / 月

20.3 万

整机系统产量 / 月

增值服务

- 裸机组装 & 操作系统安装
- 强化生产
- 提供实验室验证



CTOS



涂层



温度测试



实验室验证

生产规模 & 实力

7天周转

- 关注客户痛点
- MTTR 很短
- 确保高质量保修

5大RMA中心

- 本地化支持
- 丰富的客户服务经验
- 运输周期短 & 运费成本低

定期质量审查

- 与产品团队定期进行 QPM 质量评审
- 采取预防措施

全球覆盖 本地化支持 售后服务



5
区域 RMA 中心
92
名技术支持工程师

8
区域 RMA 中心
261
名销售代表

2
授权 RMA 中心
51
名项目经理

研华嵌入式在线服务

ADVANTECH Online

研华嵌入式提供便捷、权威的官方线上顾问式销售渠道，在线服务团队由在线客服、产品经理、技术支持等组成，共同为您提供从售前到售后一站式高效服务，满足您的多元化需求。

客户服务

服务时间：周一到周五 8:30-17:30



400-001-9088

研华嵌入式服务专线



400-001-9088

研华嵌入式QQ在线客服



微信扫码 立即咨询

研华嵌入式微信在线客服



ADVANTECH IoTMart

研华官方电商平台



ADVANTECH 1688.com

研华1688电商平台

服务流程



在线咨询



方案报价



多种下单方式
(平台&线下)



多仓发货



全国售后服务

研华橙悦客服

研华橙悦客服在全国设有4个客户服务中心, 1个维修中心和70+橙悦服务站点。可提供包括7x24小时热线技术支持、标准质保服务以及“便捷、健捷、智捷、租赁”全方位的增值服务, 帮助用户延长设备的使用寿命, 实现设备使用价值的最大化。

目前服务渠道已开通专线电话、网站及微信。用户通过官方微信平台(公众号:研华售后服务)还可以体验到一站式快速且便捷的自助服务, 包括:

- 驱动链接下载
- 质保、原装整机查询
- 在线技术、服务咨询

增值服务



便捷服务

上门/延保/定制服务



健捷服务

维护保养/整场运维



智捷服务

系统集成/项目管理



租赁服务

设备租赁/行业方案/私有云租赁

服务渠道



嵌入式专线: 400-001-9088
售前咨询: 800-810-0345(座机)
400-810-0345(手机)
橙悦客服: 800-810-8389(座机)
400-810-8389(手机)



邮件咨询
EC.AonlineSales@advantech.com



QQ在线咨询
4000019088



研华在线商城
<http://www.iotmart.com.cn>
<https://advantechonline.1688.com>



研华嵌入式客服



研华橙悦客服
售后服务

服务流程



在线咨询

- 多渠道受理
- 快速响应



诊断定案

- 分析问题
- 确定定案



分类解决

- 远程修复
- 现场服务
- 寄修/换货



跟进回访

- 服务回访
- 收集反馈
- 满意度调查



优化迭代

- 分析反馈
- 持续优化

记事

研华全国联系方式

嵌入式服务专线: 400-001-9088

■ 华北地区

北京研华
010-62984346
北京市海淀区上地信息产业基地
六街七号

大连研华
0411-39769092/1

哈尔滨研华
0451-82317150

济南研华
0531-88119568

青岛研华
0532-81920601/81920602

沈阳研华
024-22813308/3309/3310

石家庄研华
0311-89105501

太原研华
0351-8330390

天津研华
022-87970187

郑州研华
0371-65976287/86108271

■ 华东地区

上海研华
021-36321616
上海市静安区江场三路136号

长沙研华
0731-82294346

杭州研华
0571-56832929

合肥研华
0551-64678530

昆山研华
0512-57775666

南昌研华
0791-86524793

南京研华
025-83690010

宁波研华
0574-87091238

苏州研华
0512-65501572

武汉研华
027-87339504/87525101

无锡研华
0510-82393455

■ 华南地区

深圳研华
0755-82124222
深圳市南山区科技南12路28号
康佳研发大厦4层

东莞研华
0769-82198217

福州研华
0591-87670508

广州研华
020-38879115

厦门研华
0592-5514180

珠海研华
0756-2609096

■ 华西地区

西安研华
029-87669933
西安市高新区科技二路68号
西安软件园秦风阁301室

成都研华
028-85450198

重庆研华
023-68618289

昆明研华
0871-63182769

兰州研华
0931-8416082

■ 港澳台地区

台北研华
0800-777-111
台北市内湖区瑞光路26巷20弄1号

香港研华
852-27205118

ADVANTECH
研華科技

www.advantech.com.cn

订购前请核实产品规格。本文件仅供参考, 所有产品规格如有变更, 恕不另行通知。
未经出版方事先书面许可, 本出版物的任何部分不得以任何形式或方式(包括电子、扫描、复印、录制等)复制。
所有品牌及产品名称均为其所属公司的商标或注册商标。
©Advantech Co., Ltd. 2026.07



研华嵌入式物联网



研华客户服务